

09/831345

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

JC18 Rec'd PCT/PTO 10 MAY 2001

IN RE APPLICATION OF: Tomoko OHTSUKI, et al.

SERIAL NO.: NEW U.S. PCT APPLICATION

FILED: HEREWITH

INTERNATIONAL APPLICATION NO.: PCT/JP00/05875

INTERNATIONAL FILING DATE: 30 August 2000

FOR: LIGHT SOURCE UNIT AND WAVELENGTH STABILIZING CONTROL METHOD, EXPOSURE APPARATUS AND EXPOSURE METHOD, METHOD OF MAKING EXPOSURE APPARATUS, AND DEVICE MANUFACTURING METHOD AND DEVICE

**REQUEST FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119
AND THE INTERNATIONAL CONVENTION**

Assistant Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

Sir:

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicant claims as priority:

<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NO.</u>	<u>DAY/MONTH/YEAR</u>
JAPAN	11/257969	10 September 1999
JAPAN	11/258089	10 September 1999
JAPAN	11/259615	13 September 1999
JAPAN	2000/153320	24 May 2000
JAPAN	2000/190826	26 June 2000

A certified copy of the corresponding Convention application(s) was submitted to the International Bureau in PCT Application No. **PCT/JP00/05875**. Receipt of the certified copy(s) by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.

Respectfully submitted,
OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.



22850

Marvin J. Spivak
Attorney of Record
Registration No. 24,913
Surinder Sachar
Registration No. 34,423

(703) 413-3000
Fax No. (703) 413-2220
(OSMMN 1/97)

PCT/JP00/05875

30.08.00

日本国特許庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

REC'D 20 OCT 2000

WIPO

PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日
Date of Application:

1999年 9月10日

出願番号
Application Number:

平成11年特許願第257969号

出願人
Applicant(s):

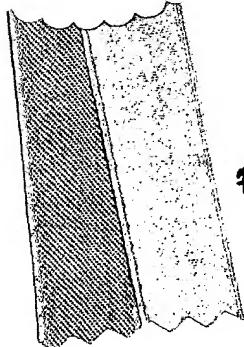
株式会社ニコン

EQU

09/831345

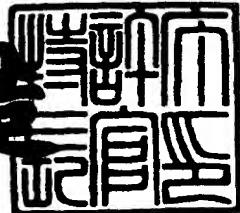
**PRIORITY
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及川耕造



2000年10月 6日

出証番号 出証特2000-3080881

【書類名】 特許願
 【整理番号】 99-00998
 【あて先】 特許庁長官殿
 【国際特許分類】 H01L 21/027
 【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株式会社 ニコ
ン内

【氏名】 大槻 朋子

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株式会社 ニコ
ン内

【氏名】 渥美 二一

【特許出願人】

【識別番号】 000004112

【氏名又は名称】 株式会社 ニコン

【代理人】

【識別番号】 100102901

【弁理士】

【氏名又は名称】 立石 篤司

【電話番号】 042-739-6625

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 053132

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9408046

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光源装置、露光装置及び露光方法、並びにデバイス及びその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 単一波長の光を発生する光源装置であって、

单一波長の光を発生する光発生部と：

前記光発生部の出力段に並列に配置された複数の光ファイバから成るファイバ群と；

前記各光ファイバからの光出力を個別にオン・オフすることにより前記ファイバ群から出力される光の光量を制御する光量制御装置とを備える光源装置。

【請求項 2】 前記ファイバ群を構成する前記複数の光ファイバは、それぞれの少なくとも出力端部が束ねられてバンドルーファイバが構成されていることを特徴とする請求項 1 に記載の光源装置。

【請求項 3】 前記各光ファイバを含んで構成される各光経路の一部には、光増幅を行うことができるファイバ増幅器が少なくとも 1 段設けられ、

前記光量制御装置は、前記各光ファイバからの前記光出力のオン・オフを前記ファイバ増幅器の励起用光源からの励起光の強度の切り換えにより行うこと特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の光源装置。

【請求項 4】 前記光量制御装置は、前記励起用光源からの励起光の強度を所定レベルと零レベルとのいずれかに択一的に設定することにより前記励起光の強度の切り換えを行うことを特徴とする請求項 3 に記載の光源装置。

【請求項 5】 前記光量制御装置は、前記励起用光源をオン・オフすることにより、前記励起光の強度を所定レベルと零レベルとのいずれかに択一的に設定することを特徴とする請求項 4 に記載の光源装置。

【請求項 6】 前記光量制御装置は、前記励起用光源からの励起光の強度を所定の第 1 レベルと該第 1 レベルより小さい第 2 レベルとのいずれかに択一的に設定することにより前記励起光の強度の切り換えを行うことを特徴とする請求項 3 に記載の光源装置。

【請求項 7】 前記各光経路には、前記ファイバ増幅器が複数段設けられ、

前記光量制御装置は、前記各光ファイバからの前記光出力のオン・オフを最終段のファイバ増幅器の励起用光源からの励起光の強度の切り換えにより行うことの特徴とする請求項3～6のいずれか一項に記載の光源装置。

【請求項8】 前記最終段の前記ファイバ増幅器は、他の段のファイバ増幅器に比べてモードフィールド径が大きいことを特徴とする請求項7に記載の光源装置。

【請求項9】 前記各光ファイバからの光出力のオン・オフ状況に対応する出力強度マップが予め記憶された記憶装置を更に備え、

前記光量制御装置は、前記出力強度マップと所定の設定光量とに基づいて前記各光ファイバからの光出力を個別にオン・オフすることを特徴とする請求項1～8のいずれか一項に記載の光源装置。

【請求項10】 前記出力強度マップは、予め測定された各ファイバ出力のばらつきに基づいて作成されていることを特徴とする請求項9に記載の光源装置。

【請求項11】 前記各光ファイバから出力される前記光の波長を変換する波長変換部を更に備えることを特徴とする請求項1～8のいずれか一項に記載の光源装置。

【請求項12】 前記各光ファイバから出力される前記光の波長を変換する波長変換部を更に備え、

前記出力強度マップは、予め測定された前記各ファイバ出力に対応する波長変換効率のばらつきに起因する出力のばらつきを更に考慮して作成されていることを特徴とする請求項9又は10に記載の光源装置。

【請求項13】 前記光発生部は、单一波長の光を発生する光源と、前記光源からの光を所定周波数のパルス光に変換して出力する光変調器とを有し、

前記光量制御装置は、前記光変調器から出力されるパルス光の周波数及びピークパワーの少なくとも一方を更に制御することを特徴とする請求項1～12のいずれか一項に記載の光源装置。

【請求項14】 前記複数の光ファイバそれぞれからの光出力を個別に遅延させて、前記光出力を時間的にずらして行わせる遅延部を更に備えることを特徴

とする請求項1～13のいずれか一項に記載の光源装置。

【請求項15】 単一波長の光を発生する光源装置であって、

单一波長の光を発生する光源と、該光源からの光を所定周波数のパルス光に変換して出力する光変調器とを有する光発生部と；

前記光発生部によって発生されたパルス光を増幅する少なくとも1段のファイバ增幅器を含む光増幅部と；

前記光変調器から出力される前記パルス光の周波数を制御することにより前記ファイバ增幅器からの出力光の光量を制御する光量制御装置とを備える光源装置。
。

【請求項16】 前記光増幅部に入力するパルス光の周波数に応じた前記光増幅部の出力強度マップが記憶された記憶装置を更に備え、

前記光量制御装置は、前記出力強度マップと所定の設定光量とに基づいて前記光変調器から出力される前記パルス光の周波数を制御することを特徴とする請求項15に記載の光源装置。

【請求項17】 前記光量制御装置は、前記光変調器から出力される前記パルス光のピークパワーを更に制御することを特徴とする請求項15又は16に記載の光源装置。

【請求項18】 前記光変調器は、電気光学変調器であり、

前記光量制御装置は、前記光変調器に印加する電圧パルスの周波数を制御することにより、前記パルス光の周波数を制御することを特徴とする請求項15又は16に記載の光源装置。

【請求項19】 单一波長の光を発生する光源装置であって、

单一波長の光を発生する光源と、該光源からの光を所定周波数のパルス光に変換して出力する光変調器とを有する光発生部と；

前記光発生部によって発生されたパルス光を増幅する少なくとも1段のファイバ增幅器を含む光増幅部と；

前記光変調装置から出力される前記パルス光のピークパワーを制御することにより前記光増幅部からの出力光の光量を制御する光量制御装置とを備える光源装置。

【請求項20】 前記光増幅部に入力するパルス光の強度に応じた前記光増幅部の出力強度マップが記憶された記憶装置を更に備え、

前記光量制御装置は、前記出力強度マップと所定の設定光量とに基づいて前記光変調器から出力される前記パルス光のピークパワーを制御することを特徴とする請求項19に記載の光源装置。

【請求項21】 前記光変調器は、電気光学変調器であり、

前記光量制御装置は、前記光変調器に印加する電圧パルスのピークレベルを制御することにより、前記パルス光のピークパワーを制御することを特徴とする請求項19又は20に記載の光源装置。

【請求項22】 前記光増幅部は複数並列に設けられ、

前記各光増幅部の光出力端部は光ファイバによりそれぞれ構成されていることを特徴とする請求項15～21のいずれか一項に記載の光源装置。

【請求項23】 前記複数の光増幅部をそれぞれ構成する前記複数の光ファイバは、束ねられてバンドルファイバが構成されていることを特徴とする請求項22に記載の光源装置。

【請求項24】 前記光増幅部から出力される光の波長を変換する波長変換部を更に備えることを特徴とする請求項15～23のいずれか一項に記載の光源装置。

【請求項25】 前記複数の光増幅部のそれぞれからの光出力を個別に遅延させて、前記光出力を時間的にずらして行わせる遅延部を更に備えることを特徴とする請求項22又は23に記載の光源装置。

【請求項26】 前記光発生部は、赤外域から可視域までの範囲内の单一波長のレーザ光を発生し、

前記波長変換部は、前記レーザ光の高調波である紫外光を出力することを特徴とする請求項11、12、24のいずれか一項に記載の光源装置。

【請求項27】 前記光発生部は、波長1.5μm付近の单一波長のレーザ光を発生し、

前記波長変換部は、前記波長1.5μm付近の前記レーザ光の8倍高調波又は10倍高調波を発生することを特徴とする請求項26に記載の光源装置。

【請求項28】 マスクに形成されたパターンを基板上に転写する露光装置であって、

請求項26又は27に記載の光源装置と；

前記光源装置から出力される光を露光用照明光として前記マスクを照明する照明光学系とを備える露光装置。

【請求項29】 前記照明光学系内には、前記マスクのパターン面上における照明光の分布を均一化するオプティカルインテグレータが設けられていることを特徴とする請求項28に記載の露光装置。

【請求項30】 前記照明光学系は、ケーラー照明系であることを特徴とする請求項28又は29に記載の露光装置。

【請求項31】 マスクに形成されたパターンを基板上に繰り返し転写する露光装置であって、

単一波長の光を発生する光源と、前記光源からの光をパルス光に変換する光変調器とを有する光発生部と；

前記光発生部によって発生されたパルス光を増幅する少なくとも1段のファイバ増幅器を含む光増幅部と；

前記増幅されたパルス光を前記マスクに照射して、該マスクを介して前記基板を露光する際に、その露光対象領域の基板上の位置に応じて前記光変調器を介して前記パルス光の周波数及びピークパワーの少なくとも一方を制御する制御装置とを備える露光装置。

【請求項32】 マスクに形成されたパターンを基板上に転写する露光装置であって、

単一波長の光を発生する光源と、前記光源からの光をパルス光に変換する光変調器とを有する光発生部と；

前記パルス光を増幅する光ファイバ増幅器を少なくとも各1段含み、前記光発生部の出力段に並列に配置された複数の光経路から成る光増幅部と；

前記光増幅部からの前記パルス光を前記マスクに照射して、該マスクを介して前記基板を露光する際に、前記各光経路からの光出力を個別にオン・オフすることにより前記光増幅部から出力されるパルス光の光量を制御する制御装置とを備

える露光装置。

【請求項33】 前記光源は、赤外域又は可視域のレーザ光を発生し、前記光增幅部で増幅された前記パルス光を紫外光に波長変換する波長変換部を更に備えることを特徴とする請求項31又は32に記載の露光装置。

【請求項34】 マスクに形成されたパターンを基板上に繰り返し転写する露光方法であって、

パルス光をファイバ増幅器を用いて少なくとも1回増幅する第1工程と；前記増幅されたパルス光を前記マスクに照射し、該マスクを介して前記基板上の露光対象領域を露光する第2工程と；

前記第1工程の処理に先立って、光源からのレーザ光を前記パルス光に変換するとともに、前記露光対象領域の基板上の位置に応じて前記パルス光の周波数及びピークパワーの少なくとも一方を制御する第3工程とを含む露光方法。

【請求項35】 前記ファイバ増幅器は、複数並列に設けられ、前記第1工程では、選択されたファイバ増幅器のみを用いて前記パルス光の増幅を行うことを特徴とする請求項34に記載の露光方法。

【請求項36】 前記光源は、赤外域又は可視域のレーザ光を発生し、前記パルス光が前記マスクに照射される前に前記増幅されたパルス光を紫外光に波長変換する第4工程を更に含むことを特徴とする請求項34又は35に記載の露光方法。

【請求項37】 フォトリソグラフィ工程を含むデバイス製造方法であって、前記フォトリソグラフィ工程で、請求項28～33のいずれか一項に記載の露光装置を用いて露光を行うことを特徴とするデバイス製造方法。

【請求項38】 フォトリソグラフィ工程を含むデバイス製造方法であって、前記フォトリソグラフィ工程で、請求項34～36のいずれか一項に記載の露光方法を用いることを特徴とするデバイス製造方法。

【請求項39】 請求項37又は38に記載のデバイス製造方法により製造されたデバイス。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、光源装置、露光装置及び露光方法、並びにデバイス及びその製造方法に係り、更に詳しくは、半導体素子、液晶表示素子等を製造する際にリソグラフィ工程で用いられる露光装置の露光用光源として好適な光源装置、該光源装置を露光用光源として備えた露光装置、該露光装置による露光方法、並びに前記露光装置及び露光方法を用いてデバイスを製造する方法及び該デバイス製造方法によって製造されるデバイスに関する。

【0002】

【従来の技術】

従来より、半導体素子（集積回路）、液晶表示素子等を製造するためのリソグラフィ工程では、種々の露光装置が用いられている。近年では、この種の露光装置としては、フォトマスク又はレチクル上に形成された微細回路パターンを、表面にフォトレジストが塗布されたウエハ又はガラスプレート等の基板上に投影光学系を介して縮小投影し、転写する、いわゆるステッパあるいはいわゆるスキーニング・ステッパ等の縮小投影露光装置が、高いスループットを有する点から主流となっている。

【0003】

しかるに、投影露光装置等の露光装置では、高スループットとともに高い解像力（解像度）が要請される。投影露光装置の解像力R、焦点深度D.O.Fは、露光用照明光の波長λ、投影光学系の開口数N.A.を用いて、次式（1）、（2）によってそれぞれ表される。

【0004】

$$R = K \cdot \lambda / N.A. \quad \dots \dots (1)$$

【0005】

$$D.F. = \lambda / 2 (N.A.)^2 \quad \dots \dots (2)$$

【0006】

上記の式（1）から明らかなように、解像力R、すなわち解像できる最小パタ

ーン線幅をより小さくするために、①比例定数Kを小さくする、②N. A. を大きくする、③露光用照明光の波長λを小さくする、の3つの方法が考えられる。ここで、比例定数Kは投影光学系やプロセスによって決まる定数であり、通常0.5～0.8程度の値をとる。この定数Kを小さくする方法は、広い意味での超解像と呼ばれている。今までに、投影光学系の改良、変形照明、位相シフトレチクルなどが提案、研究されてきた。しかし、適用できるパターンに制限があるなどの難点があった。

【0007】

一方、開口数N. A. は式(1)からその値が大きいほど解像力Rを小さくできるが、このことは同時に式(2)から明らかのように焦点深度DOFが浅くなってしまうことを意味する。このため、N. A. 値は大きくするにも限界があり、通常は0.5～0.6程度が適当とされている。

【0008】

従って、解像力Rを小さくする最も単純かつ有効な方法は、露光用照明光の波長λを小さくすることである。

【0009】

かかる理由により、ステッパ等としては紫外域の輝線(g線、i線等)を出力する超高圧水銀ランプを露光用光源とするg線ステッパ、i線ステッパが従来主として用いられていたが、近年ではより短波長のKrFエキシマレーザ光(波長248nm)を出力するKrFエキシマレーザを光源とするKrFエキシマレーザ・ステッパが主流となりつつある。現在ではさらに短波長の光源としてArFエキシマレーザ(波長193nm)を使用する露光装置の開発が進められている。

【0010】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上述したエキシマレーザは大型であること、1パルスあたりのエネルギーが大きいことにより光学部品の損傷が生じやすいこと、有毒なフッ素ガスを使用するためレーザのメンテナンスが煩雑でかつ費用が高額となるなどの、露光装置の光源として不利な点が存在する。

【0011】

また、露光装置にはウエハ毎のレジスト感度等の違いにあわせた露光量制御性能を実現することが求められ、広いダイナミックレンジ、典型的には $1 \sim 1/7$ 程度が求められる。従来のエキシマレーザを光源とする露光装置では、上記のウエハ毎のレジスト感度等の違いにあわせた露光量制御のために、例えばNDフィルタ等のエネルギー粗調器が用いられている。

【0012】

しかしながら、かかる手法による場合には、透過率が較正されたNDフィルタが必要であり、NDフィルタの耐久性、透過率の経時変化も問題になる。さらに、最大光量の $1/7$ の露光量しか必要としない場合でも、エキシマレーザは最大出力強度で動作し、出力光の $6/7$ は露光には使用されず無駄になる。また、光学部品消耗、消費電力の点でも問題があった。

【0013】

現状の露光装置には、上記のウエハ毎のレジスト感度等の違いにあわせた光量制御性能（以下、適宜「第1の露光量制御性能」と呼ぶ）の他、同一ウエハ内におけるショット領域（チップ）毎のプロセスばらつきを補正する露光量制御性能（以下、適宜「第2の露光量制御性能」と呼ぶ）が要求される。また、スキャニング・ステッパーの場合には、ショット領域内の線幅均一性を実現するための露光量制御性能（以下、適宜「第3の露光量制御性能」と呼ぶ）が更に要求される。

【0014】

現状の露光装置では、上記の第2の露光量制御性能として、ダイナミックレンジが設定露光量の±10%程度、ショット間ステッピング時間である100ms程度の時間内に設定値に制御すること、制御精度として設定露光量の±1%程度が要求されている。

【0015】

また、上記第3の露光量制御性能としては、制御精度として典型的には1ショットの露光時間である20msの時間内に設定露光量の±0.2%に設定すること、制御速度1ms程度が要求されている。

【0016】

従って、露光装置の光源として、上記第1～第3の露光量制御性能を実現するためにも、制御に必要な要請に応じた制御を行うことができる光源装置の出現が期待されている。ここで、制御に必要な要請とは、(a) 制御のダイナミックレンジ、(b) 制御精度、(c) 制御速度、(d) 検出光強度と制御量とのリニアリティの程度、(e) 省電力を目的とするエネルギーセイブの機能等である。

【0017】

本発明は、かかる事情の下になされたもので、その第1の目的は、上記の制御に必要な要請に応じた光量制御を行うことができる光源装置を提供することにある。

【0018】

本発明の第2の目的は、要求される露光量制御を容易に実現することができる露光装置及び露光方法を提供することにある。

【0019】

本発明の第3の目的は、高集積度のマイクロデバイスの生産性を向上することができるデバイス製造方法を提供することにある。

【0020】

【課題を解決するための手段】

請求項1に記載の発明は、单一波長の光を発生する光源装置であって、单一波長の光を発生する光発生部(160)と；前記光発生部の出力段に並列に配置された複数の光ファイバから成るファイバ群と；前記各光ファイバからの光出力を個別にオン・オフすることにより前記ファイバ群から出力される光の光量を制御する光量制御装置(16C)とを備える。

【0021】

これによれば、光発生部で発生した单一波長の光が、その出力段に並列に配置されたファイバ群を構成する複数の光ファイバのそれぞれに向かって進むが、光量制御装置では各光ファイバからの光出力を個別にオン・オフすることによりファイバ群から出力される光の光量を制御する。このように本発明では、ファイバ群を構成する各光ファイバの光出力を個別にオン・オフするという簡単な手法によりファイバ群から出力される光の光量制御を実現することができるとともに、

光ファイバの数に比例した複数段階の光量制御が可能となるので、広いダイナミックレンジを容易に実現することができる。この場合、各光ファイバの諸性能（ファイバ径等を含む）は異なっていても良いが、各光ファイバの諸性能がほぼ同じである場合には、光ファイバのそれぞれからの同一光量の光を出力させることができることの結果、光ファイバの数Nに応じたN段階の光量制御を正確かつ確実に実行することができる。従って、例えば、 $N \geq 100$ とすれば、1%刻み以下の精度で光量を制御することができる。この場合、制御量と光量とのリニアリティの程度も良い。勿論、この場合、NDフィルタ等のエネルギー粗調器は不要となるので、該フィルタの耐久性、透過率の経時変化等に起因する光量制御性能の劣化等の諸問題も改善できる。

【0022】

この場合において、請求項2に記載の発明の如く、前記ファイバ群を構成する前記複数の光ファイバは、それぞれの少なくとも出力端部が束ねられてバンドルーファイバ（173）が構成されていても良い。通常、光ファイバの径は細いので、100本以上束ねても直径が数mm程度以内に収めることができ、そのバンドルーファイバの出力段に何らかの光学素子を配置する場合に、小型の光学素子を配置できる。

【0023】

上記請求項1及び2に記載の各発明に係る光源装置では、各光ファイバからの光出力をオン・オフする手法は、例えば、各光ファイバに対する入射光を遮光する機械的又は電気的なシャッタ、あるいは各光ファイバからの光の出射を阻止する機械的又は電気的なシャッタを設ける等種々考えられるが、例えば、請求項3に記載の発明の如く、前記各光ファイバを含んで構成される各光経路（172_n）の一部に、光増幅を行うことができるファイバ増幅器（168_n、171_n）が少なくとも1段設けられている場合には、前記光量制御装置は、前記各光ファイバからの前記光出力のオン・オフを前記ファイバ増幅器の励起用光源（174、178）からの励起光の強度の切り換えにより行うこととしても良い。

【0024】

ここで、「各光ファイバを含んで構成される各光経路の一部に、光増幅を行う

ことができるファイバ増幅器が少なくとも1段設けられている」とは、各光経路が光ファイバとは別にその入力段に設けられた光増幅器を有している場合、各光経路を構成する光ファイバの一部がファイバ増幅器となっている場合」のいずれをも含む。

【0025】

かかる場合には、ファイバ増幅器により各光ファイバを含む光経路に入射した光を増幅できるとともに、光出力をオフすることとされた光ファイバを含む光経路に設けられた光増幅器に対する励起光の強度レベルが低く（零を含む）設定されるので、その分省エネが可能である。また、ファイバ増幅器の励起用光源からの励起光の強度の切り換えにより光出力のオン・オフを行うので、シャッタ等を用いる場合に比べて短時間で光出力のオン・オフが可能である。

【0026】

この場合において、励起光の強度レベルの切り換えは、所定範囲内の固定的でない2つのレベル間で行っても良いが、請求項4に記載の発明の如く、前記光量制御装置は、前記励起用光源からの励起光の強度を所定レベルと零レベルとのいずれかに択一的に設定することにより前記励起光の強度の切り換えを行うこととしても良い。かかる場合、請求項5に記載の発明の如く、前記光量制御装置は、前記励起用光源をオン・オフすることにより、前記励起光の強度を所定レベルと零レベルとのいずれかに択一的に設定することとしても良い。

【0027】

上記請求項3に記載の発明に係る光源装置において、請求項6に記載の発明の如く、前記光量制御装置は、前記励起用光源からの励起光の強度を所定の第1レベルと該第1レベルより小さい第2レベルとのいずれかに択一的に設定することにより前記励起光の強度の切り換えを行うこととしても良い。すなわち、ファイバ増幅器では、励起光の強度を零にしなくても所定量以下にすると、光の吸収が生じて、ファイバ増幅器からの出射光強度は殆ど零となるので、励起用光源からの励起光の強度を所定の第1レベルと該第1レベルより小さい第2レベルとのいずれかに択一的に設定することにより、光ファイバからの光出力をオン・オフすることができる。この場合も第1レベル、第2レベルは所定範囲内の固定的でな

い2つのレベルであっても良い。

【0028】

上記請求項3～6に記載の各発明に係る光源装置において、請求項7に記載の発明の如く、前記各光経路に、前記ファイバ増幅器が複数段設けられている場合、前記光量制御装置は、前記各光ファイバからの前記光出力のオン・オフを最終段のファイバ増幅器（171_n）の励起用光源からの励起光の強度の切り換えにより行うこととしても良い。かかる場合には、最終段以外のファイバ増幅器の励起用光源からの励起光の強度を切り換える場合に問題となるASE（Amplified Spontaneous Emission, 自然放出光）の悪影響を回避することができるとともに、後段のファイバ程大きな励起光の強度を必要とするので光ファイバからの光出力をオフしたときの励起用光源の省エネの効果が一層大きくなる。

【0029】

この場合において、請求項8に記載の発明の如く、前記最終段の前記ファイバ増幅器は、他の段のファイバ増幅器に比べてモードフィールド径が大きいことが望ましい。かかる場合には、光ファイバ中での非線形効果による増幅光のスペクトル幅の増加を避けることができる。

【0030】

上記請求項1～8に記載の各発明に係る光源装置において、前記各光ファイバからの光出力のオン・オフ状況に対応する出力強度マップが予め記憶された記憶装置（51）を更に備え、前記光量制御装置は、前記出力強度マップと所定の設定光量に基づいて前記各光ファイバからの光出力を個別にオン・オフすることとしても良い。かかる場合には、各光ファイバの出力にはらつきがあってもファイバ群の光出力を設定光量にほぼ一致させることができるとともに、諸性能の異なる光ファイバを用いることも可能となる。

【0031】

この場合において、前記出力強度マップは、予め測定された各ファイバ出力のはらつきに基づいて作成されていることが望ましい。かかる場合には予め実際に測定された各ファイバ出力のはらつきに基づいて出力強度マップが作成されているので、ファイバ群の光出力を設定光量に確実に一致させることができる。

【0032】

上記請求項1～8に記載の各発明に係る光源装置において、請求項11に記載の発明の如く、前記各光ファイバから出力される前記光の波長を変換する波長変換部(163)を更に備えていても良い。かかる場合には、波長変換部出力は、光出力がオンであるファイバ数に比例する。このため、例えば、各光ファイバの諸性能がほぼ同じである場合には、光ファイバのそれぞれから同一光量の光を出力させることができる結果、ニアリティ良く光量を制御することができる。

【0033】

請求項9及び10に記載の各発明に係る光源装置において、請求項12に記載の発明の如く、前記各光ファイバから出力される前記光の波長を変換する波長変換部を更に備える場合には、前記出力強度マップは、予め測定された前記各ファイバ出力に対応する波長変換効率のばらつきに起因する出力のばらつきを更に考慮して作成されていることが望ましい。かかる場合には、各光ファイバからの光出力に対する波長変換効率にばらつきがあっても、出力光の光量を設定光量に制御することができる。

【0034】

上記請求項1～12に記載の各発明に係る光源装置において、請求項13に記載の発明の如く、前記光発生部が、单一波長の光を発生する光源(160A)と、前記光源からの光を所定周波数のパルス光に変換して出力する光変調器(160C)とを有する場合には、前記光量制御装置は、前記光変調器から出力されるパルス光の周波数及びピークパワーの少なくとも一方を更に制御することとしても良い。かかる場合には、光ファイバ群を構成する各ファイバの光出力の個別オン・オフによる段階的な光量制御に加えて、各段階間の光量の微調整が光変調器から出力されるパルス光の周波数及びピークパワーの少なくとも一方の制御により可能になるので、結果的に光量の連続制御が可能となり、所定範囲内であれば設定露光量が如何なる値に設定されても、出力光の光量をその設定光量に一致させることができるものとなる。

【0035】

上記請求項1～13に記載の各発明に係る光源装置において、請求項14に記

載の発明の如く、前記複数の光ファイバそれぞれからの光出力を個別に遅延させて、前記光出力を時間的にずらして行わせる遅延部（167）を更に備えていても良い。かかる場合には、各光ファイバから出力される光が時間的に重なることがなくなるので、結果的に空間的コヒーレンシーを低減することが可能になる。

【0036】

請求項15に記載の発明は、单一波長の光を発生する光源装置であって、单一波長の光を発生する光源（160A）と、該光源からの光を所定周波数のパルス光に変換して出力する光変調器（160C）とを有する光発生部（160）と；前記光発生部によって発生されたパルス光を増幅する少なくとも1段のファイバ增幅器を含む光増幅部（161）と；前記光変調器から出力される前記パルス光の周波数を制御することにより前記ファイバ增幅器からの出力光の光量を制御する光量制御装置（16C）とを備える。

【0037】

これによれば、光発生部内では、光源から单一波長の光が発生され、その光が光変調器によって所定周波数のパルス光に変換され出力される。そして、このパルス光は、光増幅部によって増幅されピークパワーのより大きなパルス光として出力される。しかるに、パルス光の単位時間当たりの光量（積算光量）は、パルス光のピークパワーがほぼ一定であれば、その周波数に応じて増減するので、光量制御装置が光変調器から出力されるパルス光の周波数を制御することにより、ファイバ增幅器からの出力光の光量を設定光量（目標光量）に一致させることができる。本発明によるパルス光の周波数（単位時間当たりのパルス数）制御による光量調整では、前述した請求項1に記載の発明に比べて、より高速にかつより細やかな光量調整を行うことが可能となり、設定光量が所定範囲内にあれば如何なる値に設定されても光量をほぼ一致させることができる。また、光出力と制御量とのリニアリティも請求項1に記載の発明と同等以上になる。

【0038】

この場合において、請求項16に記載の発明の如く、前記光増幅部に入力するパルス光の周波数に応じた前記光増幅部の出力強度マップが記憶された記憶装置（51）を更に備える場合には、前記光量制御装置は、前記出力強度マップと所

定の設定光量に基づいて前記光変調器から出力される前記パルス光の周波数を制御することとしても良い。光変調器からのパルス光の周波数に応じて光増幅器の入力光の強度が変化し、光増幅部を構成するファイバ増幅器の利得は入力光強度依存性を有するが、本発明によれば、前記入力光強度依存性に起因する光増幅部からの出力パルスのピークパワー変化の影響を受けることのない、高精度な光量制御が可能となる。

【0039】

上記請求項15及び16に記載の各発明において、請求項17に記載の発明の如く、前記光量制御装置は、前記光変調器から出力される前記パルス光のピークパワーを更に制御することとしても良い。かかる場合には、パルス光のピークパワーに変動があるような場合であっても、精度の良い光量制御が可能となる。

【0040】

上記請求項15及び16に記載の各発明において、請求項18に記載の発明の如く、前記光変調器が、電気光学変調器である場合に、前記光量制御装置は、前記光変調器に印加する電圧パルスの周波数を制御することにより、前記パルス光の周波数を制御することとしても良い。電気光学変調器の出力パルス光の周波数は、その光変調器に印加する電圧パルスの周波数に一致する。

【0041】

請求項19に記載の発明は、单一波長の光を発生する光源装置であって、单一波長の光を発生する光源(160A)と、該光源からの光を所定周波数のパルス光に変換して出力する光変調器(160C)とを有する光発生部(160)と；前記光発生部によって発生されたパルス光を増幅する少なくとも1段のファイバ増幅器を含む光増幅部(161)と；前記光変調装置から出力される前記パルス光のピークパワーを制御することにより前記光増幅部からの出力光の光量を制御する光量制御装置(16C)とを備える。

【0042】

これによれば、光発生部内では、光源から单一波長の光が発生され、その光が光変調器によって所定周波数のパルス光に変換され出力される。そして、このパルス光は、光増幅部によって増幅されピークパワーのより大きなパルス光として

出力される。光増幅部から出力されるパルス光の単位時間当たりの光量（積算光量）は、当然に光変調器からのパルス光のピークパワーに応じて増減するので、光量制御装置が光変調器から出力されるパルス光のピークパワーを制御することにより、ファイバ増幅器からの出力光の光量を設定光量（目標光量）に一致させることができる。本発明によるパルス光のピークパワー制御による光量調整では、前述した請求項1に記載の発明に比べて、より高速にかつより細やかな光量調整を行うことが可能となり、設定光量が所定範囲内にあれば如何なる値に設定されても光量をほぼ一致させることができる。

【0043】

この場合において、請求項20に記載の発明の如く、前記光増幅部に入力するパルス光の強度に応じた前記光増幅部の出力強度マップが記憶された記憶装置（51）を更に備える場合には、前記光量制御装置は、前記出力強度マップと所定の設定光量に基づいて前記光変調器から出力される前記パルス光のピークパワーを制御することとしても良い。かかる場合には、光増幅部を構成するファイバ増幅器の利得の入力光強度依存性に起因する光増幅部からの出力パルスのピークパワー変化の影響を受けることのない、高精度な光量制御が可能となる。

【0044】

請求項19及び20に記載の各発明において、請求項21に記載の発明の如く、前記光変調器は、電気光学変調器であり、前記光量制御装置は、前記光変調器に印加する電圧パルスのピークレベルを制御することにより、前記パルス光のピークパワーを制御することとしても良い。電気光学変調器からの出力光のパルスピーク強度は電気光学変調器に印加される電圧パルスのパルスピーキー强度に依存する。

【0045】

請求項15～21に記載の各発明に係る光源装置において、請求項22に記載の発明の如く、前記光増幅部は複数並列に設けられ、前記各光増幅部の光出力端部は光ファイバによりそれぞれ構成されていても良い。

【0046】

この場合において、請求項23に記載の発明の如く、前記複数の光増幅部をそ

れぞれ構成する前記複数の光ファイバは、束ねられてバンドルーファイバ(173)が構成されていても良い。通常、光ファイバの径は細いので、100本以上束ねても直径が数mm程度以内に収めることができ、そのバンドルーファイバの出力段に何らかの光学素子を配置する場合に、小型の光学素子を配置できる。

【0047】

上記請求項15～23に記載の各発明に係る光源装置において、請求項24に記載の発明の如く、前記光増幅部から出力される光の波長を変換する波長変換部(163)を更に備えていても良い。かかる場合には、波長変換部からの出力光の光量は、光増幅部出力、ひいては光変調器からのパルス光の入力強度(光量)に応じた値となる。但し、確実にパルス光の入力強度(光量)に比例した値となるわけではなく、光増幅部の出力パルスのピーク強度に対し、最高で波長変換部から出力される高調波の次数のべき乗に比例した非線形の依存性を示す。一方、前記光変調器が電気光学変調器である場合には、その出力光のパルスピーキー强度の、電気光学変調器に印加される電圧パルスのパルスピーキー强度依存性は、 $c \cdot s$ (V)であるため、上記の波長変換部の非線形な依存性は緩和される。従って、波長変換部を備える場合には、前記光変調器は、電気光学変調器であることが望ましい。

【0048】

上記請求項22及び23に記載の各発明において、請求項25に記載の発明の如く、前記複数の光増幅部のそれぞれからの光出力を個別に遅延させて、前記光出力を時間的にずらして行わせる遅延部(167)を更に備えていても良い。かかる場合には、各光ファイバから出力される光が時間的に重なることがなくなるので、結果的に空間的コヒーレンシーを低減することが可能になる。

【0049】

上記請求項11、12、24に記載の各発明に係る光源装置において、請求項26に記載の発明の如く、前記光発生部は、赤外域から可視域までの範囲内の单一波長のレーザ光を発生し、前記波長変換部は、前記レーザ光の高調波である紫外光を出力することを特徴としても良い。

【0050】

この場合において、請求項27に記載の発明の如く、前記光発生部は、波長1.5 μm付近の单一波長のレーザ光を発生し、前記波長変換部は、前記波長1.5 μm付近の前記レーザ光の8倍高調波又は10倍高調波を発生することとしても良い。

【0051】

請求項28に記載の発明は、マスク(R)に形成されたパターンを基板(W)

上に転写する露光装置であって、請求項26又は27に記載の光源装置(16)と；前記光源装置から出力される光を露光用照明光として前記マスクを照明する照明光学系(12)とを備える。

【0052】

これによれば、照明光学系により光源装置の波長変換部から出力される紫外光を露光用照明光としてマスクが照明され、該マスクに形成されたパターンが基板上に転写される。この場合、光源装置により、マスクに照射される紫外光の光量制御を必要な要請に応じて行うことができるので、結果的に要求される露光量制御を実現することができる。

【0053】

この場合において、請求項29に記載の発明の如く、前記照明光学系内には、前記マスクのパターン面上における照明光の分布を均一化するオプティカルインテグレータ(22)が設けられていても良い。特に、光ファイバが複数並列に設けられる場合には、オプティカルインテグレータによりマスク面上での照明光分布が各光ファイバからの光出力の変動(オン・オフを含む)によって変動するのを抑制することができるので、特に望ましい。

【0054】

請求項28及び29に記載の各発明に係る露光装置において、請求項30に記載の発明の如く、前記照明光学系は、ケーラー照明系であっても良い。

【0055】

請求項31に記載の発明は、マスクに形成されたパターンを基板上に繰り返し転写する露光装置であって、单一波長の光を発生する光源(160A)と、前記光源からの光をパルス光に変換する光変調器(160C)とを有する光発生部(

160)と;前記光発生部によって発生されたパルス光を増幅する少なくとも1段のファイバ増幅器を含む光増幅部(161)と;前記増幅されたパルス光を前記マスクに照射して、該マスクを介して前記基板を露光する際に、その露光対象領域の基板上の位置に応じて前記光変調器を介して前記パルス光の周波数及びピークパワーの少なくとも一方を制御する制御装置(50)とを備える。

【0056】

これによれば、光発生部では、光源で発生した単一波長の光を光変調器によりパルス光に変換することによりパルス光を発生し、そのパルス光がファイバ増幅器を含む光増幅部によって増幅される。そして、制御装置により、その増幅されたパルス光をマスクに照射して、該マスクを介して基板を露光する際に、その露光対象領域の基板上の位置に応じて光変調器を介してパルス光の周波数及びピークパワーの少なくとも一方が制御され、これによりマスクに照射される光量、ひいては基板の露光量が高精度に制御される。従って、本発明によれば、基板上の露光対象領域の位置によらず、常に適切な露光量制御が可能となり、精度良くマスクのパターンを基板上に転写することが可能になる。

【0057】

ここで「露光対象領域」とは、基板上に露光すべきショット領域が複数ある場合のそれぞれのショット領域、及び各ショット領域内の異なる領域の双方を含む概念である。従って、本発明によれば、いわゆるステッパ(スキャニング・ステッパを含む)における基板上の各ショット領域毎のプロセスばらつきの補正や走査型露光装置における1ショット領域内の線幅均一性の向上が可能になる。

【0058】

請求項32に記載の発明は、マスク(R)に形成されたパターンを基板(W)上に転写する露光装置であって、単一波長の光を発生する光源(160A)と、前記光源からの光をパルス光に変換する光変調器(160C)とを有する光発生部(160)と;前記パルス光を増幅するファイバ増幅器を少なくとも各1段含み、前記光発生部の出力段に並列に配置された複数の光経路(172_n)から成る光増幅部(161)と;前記光増幅部からの前記パルス光を前記マスクに照射して、該マスクを介して前記基板を露光する際に、前記各光経路からの光出力を

個別にオン・オフすることにより前記光増幅部から出力されるパルス光の光量を制御する制御装置(50)とを備える。

【0059】

これによれば、光発生部では、光源で発生した単一波長の光を光変調器によりパルス光に変換することによりパルス光を発生し、そのパルス光がファイバ増幅器を含む光増幅部によって増幅される。そして、制御装置により、その増幅されたパルス光をマスクに照射して、該マスクを介して基板を露光する際に、各光経路からの光出力を個別にオン・オフすることにより光増幅部から出力されるパルス光の光量が制御され、これによりマスクに照射される光量、ひいては基板の露光量が広い範囲に渡って段階的に制御される。従って、本発明によれば、複数枚の基板を繰り返し露光する露光装置における基板毎のレジスト感度等の違いに合わせた露光量制御が可能になる。従って、レジスト感度等に影響を受けることなく、基板上にマスクパターンを要求される精度で転写することが可能になる。

【0060】

この場合も、制御装置は、上記の如くその露光対象領域の基板上の位置に応じて光変調器を介してパルス光の周波数及びピークパワーの少なくとも一方を制御するようにしても良い。

【0061】

請求項31及び32に記載の各発明において、請求項33に記載の発明の如く、前記光源は、赤外域又は可視域のレーザ光を発生し、前記光増幅部で増幅された前記パルス光を紫外光に波長変換する波長変換部を更に備えていても良い。

【0062】

請求項34に記載の発明は、マスクに形成されたパターンを基板上に繰り返し転写する露光方法であって、パルス光をファイバ増幅器を用いて少なくとも1回増幅する第1工程と；前記増幅されたパルス光を前記マスクに照射し、該マスクを介して前記基板上の露光対象領域を露光する第2工程と；前記第1工程の処理に先立って、光源からのレーザ光を前記パルス光に変換するとともに、前記露光対象領域の基板上の位置に応じて前記パルス光の周波数及びピークパワーの少なくとも一方を制御する第3工程とを含む。

【0063】

これによれば、パルス光をファイバ増幅器を用いて少なくとも1回増幅し、その増幅されたパルス光をマスクに照射し、該マスクを介して基板上の露光対象領域を露光する。この場合、パルス光をファイバ増幅器を用いて増幅するのに先立って、光源からのレーザ光をパルス光に変換するとともに、露光対象領域の基板上の位置に応じてパルス光の周波数及びピークパワーの少なくとも一方を制御する。従って、パルス光をマスクに照射し、該マスクを介して基板上の露光対象領域を露光する際には、露光対象領域の基板上の位置に応じて露光量が調整された状態で露光が行われることになる。従って、本発明によれば、基板上の露光対象領域の位置によらず、常に適切な露光量制御が可能となり、精度良くマスクのパターンを基板上に転写することが可能になる。

【0064】

ここで「露光対象領域」とは、基板上に露光すべきショット領域が複数ある場合のそれぞれのショット領域、及び各ショット領域内の異なる領域の双方を含む概念である。従って、本発明によれば、いわゆるステッパ（スキャニング・ステッパを含む）における基板上の各ショット領域毎のプロセスばらつきの補正や走査型露光装置における1ショット領域内の線幅均一性の向上が可能になる。

【0065】

この場合において、請求項35に記載の発明の如く、前記ファイバ増幅器が、複数並列に設けられている場合には、前記第1工程では、選択されたファイバ増幅器のみを用いて前記パルス光の増幅を行うこととしても良い。かかる場合には、露光量の制御を広いダイナミックレンジで段階的に行うことができるので、上記の露光対象領域の基板上の位置に応じてパルス光の周波数及びピークパワーの少なくとも一方を制御する露光量制御との併用により、より広い範囲に渡って露光量制御を高精度に行なうことが可能になる。上記のファイバ増幅器の選択を、基板上のレジスト感度等に応じて行うことにより、基板毎のレジスト感度の違いに合わせた露光量の制御が可能になる。

【0066】

上記請求項34及び35に記載の各発明において、請求項36に記載の発明の

如く、前記光源は、赤外域又は可視域のレーザ光を発生し、前記パルス光が前記マスクに照射される前に前記増幅されたパルス光を紫外光に波長変換する第4工程を更に含んでいても良い。

【0067】

請求項37に記載の発明は、フォトリソグラフィ工程を含むデバイス製造方法であって、前記フォトリソグラフィ工程で、請求項28～33のいずれか一項に記載の露光装置を用いて露光を行うことを特徴とする。また、請求項38に記載の発明は、フォトリソグラフィ工程を含むデバイス製造方法であって、前記フォトリソグラフィ工程で、請求項34～36のいずれか一項に記載の露光方法を用いることを特徴とする。

【0068】

これらのデバイス製造方法によれば、上記請求項28～33に記載の各露光装置、請求項34～36に記載の各露光方法により精度良くマスクのパターンを基板上に転写することが可能になる結果、高集積度のマイクロデバイスの生産性を向上することができる。

【0069】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の一実施形態を図1～図6に基づいて説明する。

【0070】

図1には、本発明に係る光源装置を含んで構成された一実施形態に係る露光装置10の概略構成が示されている。この露光装置10は、ステップ・アンド・スキヤン方式の走査型露光装置である。

【0071】

この露光装置10は、光源装置16及び照明光学系12から成る照明系、この照明系からの露光用照明光（以下、「露光光」という）ILにより照明されるマスクとしてのレチクルRを保持するレチクルステージRST、レチクルRから射出された露光光ILを基板としてのウエハW上に投射する投影光学系PL、ウエハWを保持する基板ステージとしてのエチルトステージ58が搭載されたXYステージ14、及びこれらの制御系等を備えている。

【0072】

前記光源装置16は、例えば、波長193nm(ArFエキシマレーザ光とほぼ同一波長)の紫外パルス光、あるいは波長157nm(F₂レーザ光とほぼ同一波長)の紫外パルス光を出力する高調波発生装置である。この光源装置16は、光源としてのレーザ光源を含む光源部16A、レーザ制御装置16B及び光量制御装置16Cとを備えている。この光源装置16は、前記照明光学系12、レチクルステージRST、投影光学系PL、ズームルトステージ58、XYステージ14及びこれら各部が搭載された不図示の本体コラム等から成る露光装置本体とともに、温度、圧力、湿度等が高精度に調整されたエンバイロンメンタル・チャンバ(以下、「チャンバ」という)11内に収納されている。

【0073】

図2には、光源装置16の内部構成が装置全体を統括制御する主制御装置50とともにブロック図にて示されている。

【0074】

この図2に示されるように、光源部16Aは、光発生部としてのパルス光発生部160、光増幅部161、四分の一波長板162、波長変換部163、ビームモニタ機構164及び吸収セル165等を含んで構成されている。

【0075】

前記パルス光発生部160は、レーザ光源160A、光カップラBS1, BS2、光アイソレータ160B及び光変調器としての電気光学変調器(以下、「EOM」という)160C等を有する。なお、レーザ光源160Aと波長変換部163との間の各要素間は光ファイバにより光学的に接続されている。

【0076】

前記レーザ光源160Aとしては、ここでは、单一波長発振レーザ、例えば、発振波長1.544μm、連続波出力(以下「CW出力」という)20mWのInGaAsP, DFB半導体レーザが用いられている。以下においては、レーザ光源160Aを適宜「DFB半導体レーザ160A」とも呼ぶものとする。

【0077】

ここで、DFB半導体レーザとは、縦モード選択性の低いファブリーペロー型

共振器の代わりに、回折格子を半導体レーザ内に作り上げたもので、どのような状況下であっても単一縦モード発振をするように構成されており、分布帰還型(Distributed Feedback : DFB)レーザと呼ばれるものである。この様なレーザでは基本的に単一縦モード発振をすることから、その発振スペクトル線幅は0.01 pm以下に抑えられる。

【0078】

また、DFB半導体レーザは、通常、ヒートシンクの上に設けられ、これらが筐体内に収納されている。本実施形態では、DFB半導体レーザ160Aに付設されるヒートシンク上に温度調整器（例えばペルチエ素子など）が設けられており、後述するように、レーザ制御装置16Bがその温度を制御することにより発振波長が制御（調整）可能な構成となっている。

【0079】

すなわち、DFB半導体レーザの発振波長は0.1 nm/°C程度の温度依存性を持つ。従って、例えば、DFB半導体レーザの温度を1°C変化させると、基本波(1544 nm)ではその波長が0.1 nm変化するので、8倍波(193 nm)ではその波長が0.0125 nm変化し、10倍波(157 nm)ではその波長が0.01 nm変化することになる。

【0080】

なお、露光装置では露光用照明光（パルス光）の波長をその中心波長に対して±20 pm程度変化させることができれば十分である。従って、DFB半導体レーザ11の温度を8倍波では±1.6°C程度、10倍波では±2°C程度変化させれば良い。

【0081】

なお、レーザ光源160Aとして、DFB半導体レーザ等の半導体レーザに限らず、例えば発振波長が990 nm付近のイットリビウム(Yb)・ドープ・ファイバーレーザなどを用いることもできる。

【0082】

前記光カップラBS1、BS2としては、透過率が97%程度のものが用いられている。このため、DFB半導体レーザ160Aからのレーザ光は光カップラ

B S 1 で分波され、その 97 % 程度が光カップラ B S 2 に入射し、残り 3 % 程度がビームモニタ機構 164 に入射する。また、光カップラ B S 2 に入射したレーザ光は、該光カップラ B S 2 で分波され、その 97 % 程度が次段の光アイソレータ 160B に向かって進み、残り 3 % 程度が吸収セル 165 に入射するようになっている。

【0083】

なお、ビームモニタ機構 164、吸収セル 165 等については、後に更に詳述する。

【0084】

前記光アイソレータ 160B は、光カップラ B S 2 から EOM 160C に向かう方向の光のみを通過させ、反対向きの光の通過を阻止するためのデバイスである。この光アイソレータ 160B により、反射光（戻り光）に起因する DFB 半導体レーザ 160A の発振モードの変化や雑音の発生等が防止される。

【0085】

前記 EOM 160C は、光アイソレータ 160B を通過したレーザ光（CW 光（連続光））をパルス光に変換するためのものである。EOM 160C としては、屈折率の時間変化に伴うチャープによる半導体レーザ出力の波長広がりが小さくなるように、チャープ補正を行った電極構造を持つ電気光学変調器（例えば二電極型変調器）が用いられている。EOM 160C は、光量制御装置 16C から印加される電圧パルスに同期して変調されたパルス光を出力する。一例として、EOM 160C により DFB 半導体レーザ 160A で発振されたレーザ光がパルス幅 1 n s、繰り返し周波数 100 kHz（パルス周期約 10 μ s）のパルス光に変調されるものとすると、この光変調の結果、EOM 160C から出力されるパルス光のピーク出力は 20 mW、平均出力は 2 μ W となる。なお、ここでは、EOM 160C の挿入による損失がないものとしたが、その挿入損失がある、例えば損失が -3 dB である場合、パルス光のピーク出力は 10 mW、平均出力は 1 μ W となる。

【0086】

なお、繰り返し周波数を 100 kHz 程度以上に設定した場合には、後述する

ファイバ増幅器においてA S E (Amplified Spontaneous Emission, 自然放出光) ノイズの影響による増幅率低下を阻止することができるので、このようにすることが望ましい。

【0087】

なお、EOM160Cのみを用いてパルス光をオフの状態にしてもその消光比が充分でない場合には、DFB半導体レーザ160Aの電流制御を併用することが望ましい。すなわち、半導体レーザなどではその電流制御を行うことで、出力光をパルス発振させることができるので、DFB半導体レーザ160Aの電流制御とEOM160Cとを併用してパルス光を発生させることが望ましい。一例として、DFB半導体レーザ160Aの電流制御によって、例えば10~20ns程度のパルス幅を有するパルス光を発振させるとともに、EOM160Cによってそのパルス光からその一部のみを切り出し、パルス幅が1nsのパルス光に変調する。このようにすれば、EOM160Cのみを用いる場合に比べて、パルス幅が狭いパルス光を容易に発生させることが可能になるとともに、パルス光の発振間隔や発振の開始及びその停止などをより簡単に制御することが可能になる。

【0088】

なお、EOM160Cに代えて、音響光学光変調素子(AOM)を用いることも可能である。

【0089】

前記光増幅部161は、EOM160Cからのパルス光を増幅するもので、ここでは、複数のファイバ増幅器を含んで構成されている。図3には、この光増幅部161の構成の一例が、EOM160Cとともに示されている。

【0090】

この図3に示されるように、光増幅部161は、チャネル0からチャネル127の総計128チャネルを有する遅延部167と、この遅延部167のチャネル0からチャネル127の総計128チャネルのそれぞれの出力段に接続されたファイバ増幅器168₁~168₁₂₈と、これらのファイバ増幅器168₁~168₁₂₈のそれぞれに狭帯域フィルタ169₁~169₁₂₈及び光アイソレータ170₁~170₁₂₈をそれぞれ介して接続された最終段のファイバ増幅器171₁~17

1_{128} 等を備えている。この場合、図3からも明らかなように、ファイバ増幅器 168_n 、狭帯域化フィルタ 169_n 、光アイソレータ 170_n 、及びファイバ増幅器 171_n ($n = 1, 2, \dots, 128$) によって、それぞれ光経路 172_n ($n = 1, 2, \dots, 128$) が構成されている。

【0091】

光増幅部161の上記構成各部について更に詳述すると、前記遅延部167は
 、総計128チャネルのチャネルを有し、各チャネルの出力に所定の遅延時間（ここでは、 3 n s ）を与えるためのものである。この遅延部167は、本実施形態では、EOM160Cから出力されるパルス光を35dB (3162倍) の光増幅を行うエルビウム (Er) ・ドープ・ファイバ増幅器 (EDFA) と、このEDFAの出力をチャネル0～3の4出力に並列分割する光分岐手段であるスプリッタ（平板導波路 1×4 スプリッタ）と、このスプリッタのチャネル0～3の各出力端に接続された各々長さの異なる4本の光ファイバと、これら4本の光ファイバの出力をそれぞれチャネル0～31に32分割する4つのスプリッタ（平板導波路 1×32 スプリッタ）と、各スプリッタのチャネル0を除くチャネル1～31にそれぞれ接続された長さの異なる各31本（総計124本）の光ファイバとを含んで構成されている。以下、上記各スプリッタ（平板導波路 1×32 スプリッタ）の0～31チャネルを総称してブロックと呼ぶ。

【0092】

これを更に詳述すると、上記初段のEDFAから出力されるパルス光は、ピーク出力約63W、平均出力約6.3mWとなる。このパルス光がスプリッタ（平板導波路 1×4 スプリッタ）によりチャネル0～3の4出力に並列分割され、各チャネルの出力光には、上記4本の光ファイバ長に対応した遅延が与えられる。例えば本実施形態では、光ファイバ中の光の伝搬速度を $2 \times 10^8\text{ m/s}$ であるとし、スプリッタ（平板導波路 1×4 スプリッタ）のチャネル0、1、2、3にそれぞれ0.1m、1.9m、3.3m、3.8m、5.5m、5.7m、7.7mの長さの光ファイバ（以下、「第1の遅延ファイバ」と呼ぶ）が接続されている。この場合、各第1の遅延ファイバ出口での隣り合うチャネル間の光の遅延は96nSとなる。

【0093】

また、上記4つのスプリッタ（平板導波路 1×32 スプリッタ）のチャネル1～31には、それぞれ $0.6 \times N$ メートル（Nはチャネル番号）の長さの光ファイバ（以下、「第2の遅延ファイバ」と呼ぶ）が接続されている。この結果、各ブロック内の隣り合うチャネル間では 3 n s の遅延が与えられ、各ブロックのチャネル0出力に対し、チャネル31出力は、 $3 \times 31 = 93\text{ n s}$ の遅延が与えられる。

【0094】

一方、第1から第4までの各ブロック間には、前記のように第1の遅延ファイバによって、各ブロックの入力時点で各々 96 n s の遅延が与えられている。従って、第2ブロックのチャネル0出力は第1ブロックのチャネル0出力に対し 96 n s の遅延となり、第1ブロックのチャネル31との遅延は 3 n s となる。このことは、第2～第3、第3～第4のブロック間においても同様である。この結果、全体の出力として総計128チャネルの出力端で、隣り合うチャネル間に 3 n s の遅延を持つパルス光が得られる。

【0095】

以上の分岐及び遅延により、総計128チャネルの出力端では、隣り合うチャネル間で 3 n s の遅延を持つパルス光が得られるが、このとき各々の出力端で観測される光パルスは、EOM160Cによって変調されたパルスと同じ 100 kHz （パルス周期 $10\mu\text{s}$ ）である。従って、レーザ光発生部全体として見ると、128パルスが 3 n s 間隔で発生した後、 $9.62\mu\text{s}$ の間隔を置いて次のパルス列が発生するという繰り返しが 100 kHz で行われる。即ち全体の出力は $128 \times 100 \times 10^3 = 1.28 \times 10^7$ パルス／秒となる。

【0096】

なお本実施形態では、分割数を128とし、また遅延用ファイバとして短いものを用いた例について説明した。このため各パルス列の間に $9.62\mu\text{s}$ の発光しない間隔が生じたが、分割数を増加させる、または遅延用ファイバをより長くして適切な長さとする、あるいはこれらを組み合わせて用いることにより、パルス間隔を完全な等間隔とすることも可能である。

【0097】

前記ファイバ増幅器 168_n ($n = 1, 2, \dots, 128$) としては、ここでは、通常通信で用いられているものと同様に光ファイバのモードフィールド径（以下「モード径」という）が $5 \sim 6 \mu\text{m}$ のエルビウム（Er）・ドープ・ファイバ増幅器（EDFA）が用いられている。このファイバ増幅器 168_n によって、遅延部 167 の各チャネルからの出力光が、所定の增幅利得に応じて増幅される。なお、このファイバ増幅器 168_n の励起光源等については後述する。

【0098】

前記狭帯域フィルタ 169_n ($n = 1, 2, \dots, 128$) は、ファイバ増幅器 168_n で発生するASE光をカットし、かつDFB半導体レーザ $160A$ の出力波長（波長幅は 1 pm 程度以下）を透過させることで、透過光の波長幅を実質的に狭帯化するものである。これにより、ASE光が後段のファイバ増幅器 171_n に入射してレーザ光の増幅利得を低下させるのを防止し、あるいはASEノイズの伝播によるレーザ光の散乱を防止することができる。ここで、狭帯域フィルタ 169_n はその透過波長幅が 1 pm 程度であることが好ましいが、ASE光の波長幅は数十nm程度であるので、現時点で得られる透過波長幅が 100 pm 程度の狭帯域フィルタを用いても実用上問題がない程度にASE光をカットすることができる。

【0099】

また、本実施形態では、後述するようにDFB半導体レーザ $160A$ の出力波長を積極的に変化させることがあるので、その出力波長の可変幅（本実施形態の露光装置では一例として $\pm 20 \text{ pm}$ 程度）に応じた透過波長幅（可変幅と同程度以上）を持つ狭帯域フィルタを用いておくことが好ましい。なお、露光装置に適用されるレーザ装置ではその波長幅が 1 pm 程度以下に設定される。

【0100】

前記光アイソレータ 170_n ($n = 1, 2, \dots, 128$) は、先に説明した光アイソレータ $160B$ と同様に、戻り光の影響を低減するためのものである。

【0101】

前記ファイバ増幅器 171_n ($n = 1, 2, \dots, 128$) としては、ここでは、光ファイバ中での非線形効果による増幅光のスペクトル幅の増加を避けるた

め光ファイバのモード径が通常通信で用いられているもの（ $5 \sim 6 \mu\text{m}$ ）よりも広い、例えば $20 \sim 30 \mu\text{m}$ の大モード径のE D F Aが用いられている。このファイバ増幅器171_nは、前述したファイバ増幅器168_nで増幅された遅延部167の各チャネルからの光出力を更に増幅する。一例として、遅延部167での各チャネルの平均出力約 $50 \mu\text{W}$ 、全チャネルでの平均出力約 6.3 mW を2段のファイバ増幅器168_n、171_nによって合計 46 dB （40600倍）の増幅を行うものとすると、各チャネルに対応する光経路172_nの出力端（ファイバ増幅器171_nを構成する光ファイバの出力端）では、ピーク出力 20 kW 、パルス幅 1 n s 、パルス繰り返し周波数 100 kHz 、平均出力 2 W 、全チャネルでの平均出力 25.6 W を得る。なお、このファイバ増幅器171_nの励起光源等についても後述する。

【0102】

本実施形態では、遅延部167での各チャネルに対応する光経路172_nの出力端、すなわちファイバ増幅器171_nを構成する各光ファイバの出力端は、バンドル状に束ねられ、図4に示されるような断面形状を有するバンドルーファイバ173が形成されている。このとき、各光ファイバのクラッド直径は $125 \mu\text{m}$ 程度であることから、128本を束ねた出力端でのバンドルの直径は約 2 mm 以下とすることができます。本実施形態では、バンドルーファイバ173は最終段のファイバ増幅器171_nの出力端をそのまま用いて形成しているが、最終段のファイバ増幅器171_nに無ドープの光ファイバを結合させ、その出力端でバンドルーファイバを形成することも可能である。

【0103】

なお、標準的なモード径を持つ前段のファイバ増幅器168_nと、上記モード径の広い最終段のファイバ増幅器171_nとの接続は、テーパ状にモード径が増加する光ファイバを用いて行われている。

【0104】

次に、図5に基づいて各ファイバ増幅器の励起用光源等について説明する。図5には、光増幅部161を構成するファイバ増幅器及びその周辺部が、波長変換部163の一部とともに概略的に示されている。

【0105】

この図5において、第1段のファイバ増幅器168_nにはその励起用の半導体レーザ178がファイバ結合されるとともに、この半導体レーザ178の出力が波長分割多重化装置(Wavelength Division Multiplexer:WDM)179を通してファイバ増幅器用ドープ・ファイバに入力し、それによりこのドープ・ファイバが励起されるようになっている。

【0106】

一方大モード径をもつファイバ増幅器171_nでは、上記のモード径の大きいファイバ増幅器用ドープ・ファイバを励起するための励起用光源としての半導体レーザ174を、ファイバ増幅器用ドープ・ファイバの径に合わせた大モード径ファイバにファイバ結合し、この半導体レーザ174の出力をWDM176を用いて、光増幅器用ドープ・ファイバに入力し、ドープ・ファイバを励起する。

【0107】

この大モード径ファイバ(ファイバ増幅器)171_nで増幅されたレーザ光は波長変換部163に入射し、ここで紫外レーザ光に波長変換される。なお、この波長変換部163の構成等については後述する。

【0108】

大モード径ファイバ(ファイバ増幅器)171_nを伝播する増幅されるべきレーザ光(信号)は、主に基本モードであることが望ましく、これは、シングルモードあるいはモード次数の低いマルチモードファイバにおいて、主に基本モードを選択的に励起することにより実現できる。

【0109】

本実施形態では、大モード径ファイバに結合された高出力半導体レーザを、前方向から4個及び後方向から4個ファイバ結合している。ここで、励起用半導体レーザ光を効率良く光増幅用ドープ・ファイバに結合するためには、光増幅用ドープ・ファイバとして、クラッドが2重構造となったダブルクラッド構造の光ファイバを用いることが望ましい。このとき、励起用半導体レーザ光は、WDM176により、ダブルクラッドの内側クラッドに導入される。

【0110】

前記半導体レーザ178、174は、光量制御装置16Cによって制御されるようになっている。

【0111】

また、本実施形態では、光経路172_nを構成する光ファイバとしてファイバ増幅器168_n、171_nが設けられているため、各ファイバ増幅器のゲインの差が各チャネルの光出力のばらつきとなる。このため、本実施形態では、各チャネルのファイバ増幅器（168_n、171_n）で出力の一部が分岐され、それぞれの分岐端に設けられた光電変換素子180、181によってそれぞれ光電変換されるようになっている。これらの光電変換素子180、181の出力信号が光量制御装置16Cに供給されるようになっている。

【0112】

光量制御装置16Cでは、各ファイバ増幅器からの光出力が各増幅段で一定になるように（即ちバランスするように）、各励起用半導体レーザ（178、174）のドライブ電流をフィードバック制御するようになっている。

【0113】

さらに、本実施形態では、図5に示されるように、波長変換部163の途中でビームスプリッタにより分岐された光が光電変換素子182によって光電変換され、該光電変換素子182の出力信号が光量制御装置16Cに供給されるようになっている。光量制御装置16Cでは、この光電変換素子182の出力信号に基づいて波長変換部163における光強度をモニタし、波長変換部163からの光出力が所定の光出力となるように、励起用半導体レーザ178、174の少なくとも一方のドライブ電流をフィードバック制御する。

【0114】

このような構成とすることにより、各増幅段毎に各チャネルのファイバ増幅器の増幅率が一定化されるため、各ファイバ増幅器間に偏った負荷がかかることがなく全体として均一な光強度が得られる。また、波長変換部163における光強度をモニタすることにより、予定される所定の光強度を各増幅段にフィードバックし、所望の紫外光出力を安定して得ることができる。

【0115】

なお、光量制御装置16Cについては、後に更に詳述する。

【0116】

上述のようにして構成された光増幅部161（バンドルーファイバ173を形成する各光ファイバ出力端）からはパルス光がすべて円偏光に揃えられて出力される。これら円偏光であるパルス光は、四分の一波長板162（図2参照）によって、すべて偏光方向が同一方向となる直線偏光に変換され、次段の波長変換部163に入射する。

【0117】

前記波長変換部163は、複数の非線形光学結晶を含み、前記増幅されたパルス光（波長1.544μmの光）をその8倍高調波又は10倍高調波に波長変換して、ArFエキシマレーザと同じ出力波長（193nm）あるいはF₂レーザと同じ出力波長（157nm）のパルス紫外光を発生する。

【0118】

図6（A）、（B）には、この波長変換部163の構成例が示されている。ここで、これらの図に基づいて波長変換部163の具体例について説明する。

【0119】

図6（A）は、バンドルーファイバ173の出力端から射出される波長1.544μmの基本波を、非線形光学結晶を用いて8倍波（高調波）に波長変換して、ArFエキシマレーザと同じ波長である193nmの紫外光を発生する構成例を示す。また、図6（B）は、バンドルーファイバ173の出力端から射出される波長1.57μmの基本波を非線形光学結晶を用いて10倍波の高調波発生を行い、F₂レーザと同じ波長である157nmの紫外光を発生する構成例を示す。

【0120】

図6（A）の波長変換部では、基本波（波長1.544μm）→2倍波（波長772nm）→3倍波（波長515nm）→4倍波（波長386nm）→7倍波（波長221nm）→8倍波（波長193nm）の順に波長変換が行われる。

【0121】

これを更に詳述すると、バンドルーファイバ173の出力端から出力される波

長1. 544 μm (周波数 ω) の基本波は、1段目の非線形光学結晶533に入射する。基本波がこの非線形光学結晶533を通る際に、2次高調波発生により基本波の周波数 ω の2倍、すなわち周波数 2ω (波長は1/2の772nm) の2倍波が発生する。

【0122】

この1段目の非線形光学結晶533として、LiB₃O₅ (LBO) 結晶が用いられ、基本波を2倍波に波長変換するための位相整合にLBO結晶の温度調節による方法、NCPM (Non-Critical Phase Matching) が使用される。NCPMは、非線形光学結晶内での基本波と第二高調波との角度ずれ(Walk-off)が起こらないため高効率で2倍波への変換を可能にし、また発生した2倍波はWalk-offによるビームの変形も受けないため有利である。

【0123】

非線形光学結晶533で波長変換されずに透過した基本波と、波長変換で発生した2倍波とは、次段の波長板534でそれぞれ半波長、1波長の遅延が与えられて、基本波のみその偏光方向が90度回転し、2段目の非線形光学結晶536に入射する。2段目の非線形光学結晶536としてLBO結晶が用いられるとともに、そのLBO結晶は1段目の非線形光学結晶 (LBO結晶) 533とは温度が異なるNCPMで使用される。この非線形光学結晶536では、1段目の非線形光学結晶533で発生した2倍波と、波長変換されずにその非線形光学結晶533を透過した基本波とから和周波発生により3倍波 (波長515nm) を得る。

【0124】

次に、非線形光学結晶536で得られた3倍波と、波長変換されずにその非線形光学結晶536を透過した基本波および2倍波とは、ダイクロイック・ミラー537により分離され、ここで反射された3倍波は集光レンズ540、及びダイクロイック・ミラー543を通して4段目の非線形光学結晶545に入射する。一方、ダイクロイック・ミラー537を透過した基本波および2倍波は、集光レンズ538を通して3段目の非線形光学結晶539に入射する。

【0125】

3段目の非線形光学結晶539としてはLBO結晶が用いられ、基本波が波長変換されずにそのLBO結晶を透過するとともに、2倍波がLBO結晶で2次高調波発生により4倍波（波長386nm）に変換される。非線形光学結晶539で得られた4倍波とそれを透過した基本波とは、ダイクロイック・ミラー541により分離され、ここを透過した基本波は集光レンズ544を通過るとともに、ダイクロイックミラー546で反射されて5段目の非線形光学結晶548に入射する。一方、ダイクロイック・ミラー541で反射された4倍波は、集光レンズ542を通ってダイクロイック・ミラー543に達し、ここでダイクロイック・ミラー537で反射された3倍波と同軸に合成されて4段目の非線形光学結晶545に入射する。

【0126】

4段目の非線形光学結晶545としては、 $\beta\text{-BaB}_2\text{O}_4$ （BBO）結晶が用いられ、3倍波と4倍波とから和周波発生により7倍波（波長221nm）を得る。非線形光学結晶545で得られた7倍波は集光レンズ547を通過るとともに、ダイクロイック・ミラー546で、ダイクロイック・ミラー541を透過した基本波と同軸に合成されて、5段目の非線形光学結晶548に入射する。

【0127】

5段目の非線形光学結晶548としてLBO結晶が用いられ、基本波と7倍波とから和周波発生により8倍波（波長193nm）を得る。上記構成において、7倍波発生用BBO結晶545、及び8倍波発生用LBO結晶548のかわりに、 $\text{CsLiB}_6\text{O}_{10}$ （CLBO）結晶、あるいは $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7$ （LB4）結晶を用いることも可能である。

【0128】

この図6（A）の構成例では、4段目の非線形光学結晶545に3倍波と4倍波とが互いに異なる光路を通って入射するので、3倍波を集光するレンズ540と、4倍波を集光するレンズ542とを別々の光路に置くことができる。3段目の非線形光学結晶539で発生した4倍波はその断面形状がWalk-off現象により長円形になっている。このため、4段目の非線形光学結晶545で良好な変換効率を得るためにには、その4倍波のビーム整形を行うことが望ましい。この場合、

集光レンズ540、542を別々の光路に配置しているので、例えばレンズ542としてシリンドリカルレンズ対を用いることができ、4倍波のビーム整形を容易に行なうことが可能となる。このため、4段目の非線形光学結晶（BBO結晶）545での3倍波との重なりを良好にし、変換効率を高めることができる。

【0129】

さらに、5段目の非線形光学結晶548に入射する基本波を集光するレンズ544と、7倍波を集光するレンズ547とを別々の光路に置くことができる。4段目の非線形光学結晶545で発生した7倍波はその断面形状がWalk-off現象により長円形になっている。このため、5段目の非線形光学結晶548で良好な変換効率を得るために、その7倍波のビーム整形を行うことが好ましい。本実施例では、集光レンズ544、547を別々の光路に配置することができるので、例えばレンズ547としてシリンドリカルレンズ対を用いることができ、7倍波のビーム整形を容易に行なうことが可能となる。このため、5段目の非線形光学結晶（LBO結晶）548での基本波との重なりを良好にし、変換効率を高めることが可能である。

【0130】

なお、2段目の非線形光学結晶536と4段目の非線形光学結晶545との間の構成は図6（A）に限られるものではなく、非線形光学結晶536から発生してダイクロイック・ミラー537で反射される3倍波と、非線形光学結晶536から発生してダイクロイック・ミラー537を透過する2倍波を非線形光学結晶539で波長変換して得られる4倍波とが同時に非線形光学結晶545に入射するように、両非線形光学結晶536、545間の2つの光路長が等しくなっていれば、いかなる構成であっても構わない。このことは3段目の非線形光学結晶539と5段目の非線形光学結晶548との間でも同様である。

【0131】

発明者の行った実験によれば、図6（A）の場合、各チャネル当たりの8倍波（波長193nm）の平均出力は、45.9mWであった。従って、全128チャネルを合わせたバンドルからの平均出力は5.9Wとなり、露光装置用光源として十分な出力の、波長193nmの紫外光を提供することができる。

【0132】

この場合、8倍波（193 nm）の発生に、現在、市販品として良質の結晶が容易に入手可能なLBO結晶が用いられている。このLBO結晶は、193 nmの紫外光の吸収係数が非常に小さく、結晶の光損傷が問題とならないため耐久性の面で有利である。

【0133】

また、8倍波（例えば波長193 nm）の発生部ではLBO結晶を角度位相整合させて用いるが、この位相整合角が大きいために実効非線形光学定数（ d_{eff} ）が小さくなる。そこで、このLBO結晶に温度制御機構を設け、LBO結晶を高温で用いることが好ましい。これにより、位相整合角を小さくすることができる、即ち上記定数（ d_{eff} ）を増加させることができ、8倍波発生効率を向上させることができる。

【0134】

図6 (B) の波長変換部では、基本波（波長1.57 μm）→2倍波（波長785 nm）→4倍波（波長392.5 nm）→8倍波（波長196.25 nm）→10倍波（波長157 nm）の順に波長変換する。本構成例では2倍波発生から8倍波発生までの各波長変換段において、各波長変換段に入射された波長の2次高調波発生を行っている。

【0135】

また、本構成例では波長変換に使用する非線形光学結晶として、基本波から2次高調波発生により2倍波を発生する非線形光学結晶602としてLBO結晶を使用し、2倍波から2次高調波発生により4倍波を発生する非線形光学結晶604としてLBO結晶を使用する。さらに、4倍波から2次高調波発生により8倍波を発生する非線形光学結晶609にはSr₂Be₂B₂O₇ (SBB0) 結晶を使用し、2倍波と8倍波とから和周波発生により10倍波（波長157 nm）を発生する非線形光学結晶611にはSBB0結晶を使用する。

【0136】

なお、非線形光学結晶602から発生する2倍波は、集光レンズ603を通して非線形光学結晶604に入射し、この非線形光学結晶604は前述の4倍波と

波長変換されない2倍波とを発生する。次に、ダイクロイック・ミラー605を透過する2倍波は集光レンズ606を通るとともに、ダイクロイック・ミラー607で反射されて非線形光学結晶611に入射する。一方、ダイクロイック・ミラー605で反射された4倍波は、集光レンズ608を通って非線形光学結晶609に入射し、ここで発生される8倍波は集光レンズ610、及びダイクロイック・ミラー607を通って非線形光学結晶611に入射する。さらに非線形光学結晶611は、ダイクロイック・ミラー607で同軸に合成される2倍波と8倍波とから和周波発生により10倍波（波長157nm）を発生する。

【0137】

ところで、本構成例では2段目の非線形光学結晶604から発生する2倍波と4倍波とをダイクロイック・ミラー605で分岐することで、ここを透過した2倍波と、4倍波を非線形光学結晶609で波長変換して得られる8倍波とが互いに異なる光路を通って4段目の非線形光学結晶611に入射するように構成したが、ダイクロイック・ミラー605、607を用いずに4つの非線形光学結晶602、604、609、611を同一光軸上に配置しても良い。

【0138】

但し、本構成例では2段目の非線形光学結晶604で発生した4倍波はその断面形状がWalk-off現象により長円形になっている。このため、このビームを入力とする4段目の非線形光学結晶611で良好な変換効率を得るために、入射ビームとなる4倍波のビーム形状を整形し、2倍波との重なりを良好にすることが望ましい。本構成例では、集光レンズ606、608を別々の光路に配置することができるので、例えばレンズ608としてシリンドリカルレンズを用いることが可能になり、4倍波のビーム整形を容易に行うことができる。このため、4段目の非線形光学結晶611での2倍波との重なりを良好にし、変換効率を高めることが可能である。

【0139】

なお、上記図6（A）、（B）に示される波長変換部は一例であって、本発明の波長変換部の構成がこれに限定されることは勿論である。

【0140】

図2に戻り、前記ビームモニタ機構164は、ここではファブリペロー・エタロン (Fabry-Perot etalon: 以下、「エタロン素子」ともいう) 及びフォトダイオード等の光電変換素子から成るエネルギーモニタ (いずれも図示省略) から構成されている。ビームモニタ機構164を構成するエタロン素子に入射した光は、エタロン素子の共鳴周波数と入射光の周波数との周波数差に対応した透過率で透過し、その透過光強度を検出するフォトダイオード等の出力信号がレーザ制御装置16Bに供給される。レーザ制御装置16Bではこの信号に所定の信号処理を施すことにより、ビームモニタ機構164、具体的にはエタロン素子に対する入射光の光学特性に関する情報 (具体的は、入射光の中心波長及び波長幅 (スペクトル半値幅) 等を得る。そして、この光学特性に関する情報は、リアルタイムで主制御装置50に通知される。

【0141】

エタロン素子の生成する透過光強度の周波数特性は、雰囲気の温度や圧力の影響を受け、特にその共鳴周波数 (共鳴波長) は温度依存性がある。このため、このエタロン素子の検出結果に基づいてレーザ光源160Aから発振されるレーザ光の中心波長やスペクトル半値幅を精度良く制御するためには、この共鳴波長の温度依存性を調べておくことが重要である。本実施形態では、この共鳴波長の温度依存性を予め計測し、この計測結果が温度依存性マップとして主制御装置50に併設された記憶装置としてのメモリ51 (図1参照) に記憶されている。そして、主制御装置50では、ビームモニタ機構164の絶対波長キャリブレーションの際等に、エタロン素子の透過率が最大となる共鳴波長 (検出基準波長) が設定波長に正確に一致するようにするため、レーザ制御装置16Bに指示を与えて、ビームモニタ機構164内のエタロン素子の温度を積極的に制御するようになっている。

【0142】

また、ビームモニタ機構164を構成するエネルギーモニタの出力は、主制御装置50に供給されており、主制御装置50ではエネルギーモニタの出力に基づいてレーザ光のエネルギーパワーを検出し、レーザ制御装置16Bを介してDFB半導体レーザ160Aで発振されるレーザ光の光量を必要に応じて制御したり、DF

B半導体レーザ160Aをオフしたりする。但し、本実施形態では、後述するように、通常の光量制御（露光量制御）は、主として光量制御装置16Cにより、EOM16Cの出力パルス光のピークパワーあるいは周波数の制御、又は光増幅部161を構成する各ファイバ増幅器の出力光のオン・オフ制御によって行われるので、レーザ光のエネルギーパワーが何らかの原因で大きく変動した場合に主制御装置50がレーザ制御装置16Bを上記の如く制御することとなる。

【0143】

前記吸収セル165は、DFB半導体レーザ160Aの発振波長の絶対波長キャリブレーション、すなわちビームモニタ機構164の絶対波長キャリブレーションのための絶対波長源である。本実施形態では、この吸収セル165として、レーザ光源として発振波長 $1.544\mu m$ のDFB半導体レーザ160Aが用いられている関係から、この波長近傍の波長帯域に吸収線が密に存在するアセチレンの同位体が用いられている。

【0144】

なお、後述するように、レーザ光の波長のモニタ用の光として、基本波とともにあるいはこれに代えて、上述した波長変換部163の中間波（2倍波、3倍波、4倍波等）あるいは波長変換後の光を選択する場合には、それらの中間波等の波長帯域に吸収線が密に存在する吸収セルを用いれば良い。例えば、波長のモニタ用の光として、3倍波を選択する場合には、波長 $503 nm$ ～ $530 nm$ の近傍に吸収線が密に存在するヨウ素分子を吸収セルとして用い、そのヨウ素分子の適切な吸収線を選んでその波長を絶対波長とすれば良い。

【0145】

また、絶対波長源としては、吸収セルに限らず、絶対波長光源を用いても良い。
。

【0146】

前記レーザ制御装置16Bは、ビームモニタ機構164の出力に基づいてレーザ光の中心波長及び波長幅（スペクトル半値幅）を検出し、中心波長が所望の値（設定波長）となるようにDFB半導体レーザ160Aの温度制御（及び電流制御）をフィードバック制御にて行う。本実施形態では、DFB半導体レーザ16

0 Aの温度を0.001°C単位で制御することが可能となっている。

【0147】

また、このレーザ制御装置16Bは、主制御装置50からの指示に応じて、DFB半導体レーザ160Aのパルス出力と連続出力との切替、及びそのパルス出力時における出力間隔やパルス幅などの制御を行うとともに、パルス光の出力変動を補償するように、DFB半導体レーザ160Aの発振制御を行う。

【0148】

このようにして、レーザ制御装置16Bでは、発振波長を安定化して一定の波長に制御したり、あるいは出力波長を微調整する。逆に、このレーザ制御装置16Bは、主制御装置50からの指示に応じて、DFB半導体レーザ160Aの発振波長を積極的に変化させてその出力波長を調整することもある。

【0149】

例えば、前者によれば、波長変動による投影光学系PLの収差（結像特性）の発生、又はその変動が防止され、パターン転写中にその像特性（像質などの光学的特性）が変化することがなくなる。

【0150】

また、後者によれば、露光装置が組立、調整される製造現場と露光装置の設置場所（納入先）との標高差や気圧差、更には環境（クリーンルーム内の雰囲気）の違いなどに応じて生じる投影光学系PLの結像特性（収差など）の変動を相殺でき、納入先で露光装置の立ち上げに要する時間を短縮することが可能になる。更に、後者によれば、露光装置の稼働中に、露光用照明光の照射、及び大気圧変化などに起因して生じる投影光学系PLの収差、投影倍率、及び焦点位置などの変動も相殺でき、常に最良の結像状態でパターン像を基板上に転写することが可能となる。

【0151】

前記光量制御装置16Cは、前述したように、光増幅部161内のファイバ増幅器168_n、171_nの光出力を検出する光電変換素子180、181の出力に基づいて各励起用半導体レーザ（178、174）のドライブ電流をフィードバック制御して、各増幅段毎に各チャネルのファイバ増幅器の増幅率を一定化させ

る機能と、波長変換部163途中でビームスプリッタにより分岐された光を検出する光電変換素子182の出力信号に基づいて、励起用半導体レーザ178、174の少なくとも一方のドライブ電流をフィードバック制御して予定される所定の光強度を各增幅段にフィードバックし、所望の紫外光出力を安定させる機能とを有する。

【0152】

更に、本実施形態では、光量制御装置16Cは、次のような機能をも有している。

【0153】

すなわち、光量制御装置16Cは、

- ① 主制御装置50からの指示に応じて、バンドルファイバ173を構成する各チャネルのファイバの出力、すなわち各光経路172_nの出力を個別にオン・オフ制御することにより、バンドル全体での平均光出力の制御を行う機能（以下、便宜上「第1の機能」と呼ぶ）と、
- ② 主制御装置50からの指示に応じて、EOM160Cから出力されるパルス光の周波数を制御することにより、単位時間当たりの光增幅部161の各チャネルの平均光出力（出力エネルギー）、すなわち単位時間当たりの各光経路172_nからの出力光の強度を制御する機能（以下、便宜上「第2の機能」と呼ぶ）と、
- ③ 主制御装置50からの指示に応じて、EOM160Cから出力されるパルス光のピークパワーを制御することにより、単位時間当たりの光增幅部161の各チャネルの平均光出力（出力エネルギー）、すなわち単位時間当たりの各光経路172_nからの出力光の強度を制御する機能（以下、便宜上「第3の機能」と呼ぶ）と、を有する。

【0154】

以下、上記第1～第3の機能について、詳述する。

【0155】

まず、光量制御装置16Cは、上記第1の機能における各光経路172_nの出力のオン・オフを、各チャネルの最終段のファイバ増幅器171_nからの出力をオン・オフすることにより行う。この場合、光量制御装置16Cでは、ファイバ

増幅器励起用半導体レーザ174をオン・オフする、すなわち半導体レーザ174からの励起光の強度を所定レベルと零レベルとのいずれかに択一的に設定することにより行うこともできるし、半導体レーザ174のドライブ電流の電流値を調整することにより、半導体レーザ174からの励起光の強度をファイバ増幅器171_nが増幅可能状態となる第1レベルと、ファイバ増幅器171_nが増幅不能状態となる第2レベルとのいずれかに択一的に設定することにより行なうことでもできる。増幅不能状態では、光の吸収が大きくなり、ファイバ増幅器からの出力は殆ど零となるので、各光経路172_nの出力がオフとなる。

【0156】

半導体レーザ174をオン・オフする場合には、半導体レーザ174をオフにしている状態では、その分の消費電力はなくなるので、エネルギーセイブが可能になる。一方、半導体レーザ174からの励起光の強度を上記第1レベルと第2レベルとで切り換える場合には、第1レベルと第2レベルとは固定値であっても良いが、固定値でなくても良い。すなわち、ファイバ増幅器では、励起光の強度がある値を境として、上にいくか下にいくかで、増幅可能状態となるか増幅不能状態となるかが定まるからである。

【0157】

この光量制御装置16Cの第1の機能によると、バンドル全体での平均光出力(光量)は、最大出力光量の1/128刻みで(約1%以下毎)に制御可能である。すなわち、ダイナミックレンジが1~1/128という広い範囲に設定可能である。各光経路172_nは同じ構成部材を用いて構成されているので、設計上は、各光経路172_nの光出力は等しくなる筈であり、上記1/128刻みの光量制御はリニアリティの良いものとなる。

【0158】

また、本実施形態では、光増幅部161の出力、すなわちバンドル-ファイバ173の出力を波長変換する波長変換部163が設けられているが、この波長変換部163出力は、各光経路172_nの出力、すなわちファイバ増幅器171_nの出力がオンであるファイバ数に比例するため、設定光量に対し、最大出力光量の1/128刻みのリニアな(約1%ごと)制御が原則的には可能となる筈である

【0159】

しかしながら、実際には、製造上の誤差等に起因して各光経路 172_n の出力のばらつきや、各光経路 172_n の出力に対する波長変換効率のばらつき等が存在する可能性が高いので、予め各光ファイバ（光経路 172_n ）の出力のばらつき、及び各光ファイバ出力に対する波長変換効率のばらつきに等に起因する出力のばらつきを測定し、その測定結果に基づいて各光ファイバからの光出力のオン・オフ状況に対応する波長変換部 163 からの光出力の強度のマップ（オンにするファイバグループに対応した出力強度の換算表）である第1の出力強度マップを作成し、その第1の出力強度マップを主制御装置 50 に併設されたメモリ 51 内に格納している。なお、この第1の出力強度マップは、メモリ 51 内にテープルの形で持たせても良いし、関数又は係数として持たせても良い。なお、後述する第2、第3の出力強度マップも同様である。

【0160】

そして、光量制御装置では、本第1の機能により光量制御を行う際に、主制御装置 50 から与えられる設定光量と上記の出力強度マップとに基づいて光量制御を行うようになっている。

【0161】

また、光量制御装置 $16C$ は、上記第2の機能におけるEOM $160C$ から出力されるパルス光の周波数制御を、EOM $160C$ に印加する矩形波（電圧パルス）の周波数を変えることにより行う。EOM $160C$ から出力されるパルス光の周波数はEOM $160C$ に印加する電圧パルスの周波数に一致するため、印加電圧を制御することにより出力パルス光の周波数を制御することとしたものである。

【0162】

本実施形態の場合、前述の如く、EOM $160C$ に印加する矩形波の周波数は 100 kHz である。例えば、この周波数を 110 kHz とすれば、EOM $160C$ から出力される単位時間あたりの光パルス数は 10% 増加し、このパルスが、前述と同様に、遅延部 167 により各パルス毎に順次チャネル 0 からチャネル

127の総計128チャネルに振り分けられる結果、各チャネルについて見ても単位時間当たりのパルス光は10%増加し、光パルス1個あたりの光エネルギーが同一、すなわちパルス光のピークパワーが一定であれば、単位時間当たりの各光経路_n¹⁷²の出力光強度（光量）も10%増加する。

【0163】

また、本実施形態では、光増幅部161の各チャネルの出力光の波長変換を行う波長変換部163が設けられているが、この波長変換部163の単位時間当たりの出力光の光量は、ピークパワーが一定であれば、各チャネルの出力パルスの周波数に比例する。このように、本第2の機能による光量制御は、リニアリティに優れた制御となる。

【0164】

但し、EOM160Cから出力されるパルス光は、遅延部167を経て、ファイバ増幅器_n¹⁶⁸、¹⁷¹から出力されるパルス光のピークパワーが変化する場合があるからである。ファイバ増幅器_n¹⁶⁸、¹⁷¹を適切に設計することにより、このピークパワー変化を小さく抑えることも可能ではあるが、ファイバ増幅器の光出力効率等の他の性能を低下させる場合もある。

【0165】

そこで、本実施形態では、予めファイバ増幅器出力の入力周波数強度依存性を測定し、それに基づいて光増幅部161に入力するパルス光の周波数に応じた光増幅部161（の各チャネル）の出力強度のマップである第2の出力強度マップ（EOMの出力光の周波数に対応した光増幅部161の出力強度の換算表）を作成し、その第2の出力強度マップをメモリ51に記憶している。

【0166】

そして、光量制御装置16Cでは、本第2の機能により光量制御を行う際に、主制御装置50から与えられる設定光量と上記の第2の出力強度マップとに基づ

いて光量制御を行うようになっている。

【0167】

また、光量制御装置16Cは、上記第3の機能におけるEOM160Cから出力されるパルス光のピークパワーの制御を、EOM160Cへ印加する電圧パルスのピーク強度を制御することにより行う。EOM160Cの出力光のピークパワーはEOM160Cに印加する電圧パルスのピーク強度に依存するためである。

【0168】

また、本実施形態では、光増幅部161の各チャネルの出力光の波長変換を行う波長変換部163が設けられているが、この波長変換部163の出力光強度は、各光ファイバ（光経路172_n）から出力されるパルス光のピーク強度に対し、最高では高調波の次数のべき乗に比例した非線形の依存を示す。例えば、図6(A)の8倍波発生による193nm光発生では、193nm光出力強度はファイバ増幅器出力のピークパワーの最大で8乗に比例した強度変化を示す。

【0169】

本実施形態の場合、EOM160Cから出力されるパル光のピークパワーのEOM160Cに印加する電圧パルスのピーク強度に対する依存性は、cos(V)であるため、結果的に上記の波長変換部163の非線形な依存性は緩和されるようになっている。従って、本実施形態のように波長変換部を有する光源装置では、出力光の強度（光量）制御をEOM160Cへ印加する電圧パルスのピーク強度を制御することにより行うこととは意味がある。

【0170】

但し、前述の如く、ファイバ増幅器の增幅利得は、入力光強度依存性があるため、EOM160Cから出力されるパルス光のピーク強度を変えると、ファイバ増幅器168_n、171_nの入力光強度が変化し、その結果ファイバ増幅器168_n、171_nから出力されるパルス光のピークパワーが変化する場合がある。ファイバ増幅器168_n、171_nを適切に設計することにより、このピークパワー変化を小さく抑えることも可能ではあるが、ファイバ増幅器の光出力効率等の他の性能を低下させる場合もある。

【0171】

そこで、本実施形態では、予めファイバ増幅器出力の入力パルスピーク強度依存性を測定し、それに基づいて光増幅部161に入力するパルス光のピーク強度に対応した光増幅部161（の各チャネル）の出力強度のマップである第3の出力強度マップ（EOMの出力光のピーク強度に対応した光増幅部161の出力パルス光の強度の換算表）を作成し、その第3の出力強度マップをメモリ51に記憶している。この第3の出力強度マップは波長変換部出力である紫外光強度マップであっても良い。

【0172】

そして、光量制御装置16Cでは、本第3の機能により光量制御を行う際に、主制御装置50から与えられる設定光量と上記の第3の出力強度マップとに基づいて光量制御を行うようになっている。

【0173】

なお、DFB半導体レーザ160Aの出力段に、EOM160Cの他に透過率制御用のEOMを設け、このEOMに印加する電圧を変化させることによりそのEOMの透過率を変化させて、単位時間あたりの光増幅部、波長変換部からの放出エネルギーを変えることも可能である。

【0174】

これまでの説明から明らかなように、光量制御装置16Cによる第2、第3の機能では、第1の機能に比べて、より細やかな光源装置16の出力光の光量制御が可能である。一方、第1の機能は、第2、第3の機能に比べて、ダイナミックレンジを広く設定することが可能である。

【0175】

そこで、本実施形態では、後述する露光に際して、光量制御装置16Cの上記第1の機能により露光量の粗調整を行い、第2、第3の機能を用いて露光量の微調整を行うようになっている。これについては、後述する。

【0176】

光量制御装置16Cは、この他、主制御装置50からの指示に基づいてパルス出力の開始と停止なども制御する。

【0177】

図1に戻り、前記照明光学系12は、ビーム整形光学系18、オプティカルインテグレータ（ホモジナイザ）としてのフライアイレンズ系22、照明系開口絞り板24、ビームスプリッタ26、第1リレーレンズ28A、第2リレーレンズ28B、固定レチクルブラインド30A、可動レチクルブラインド30B、光路折り曲げ用のミラーM及びコンデンサレンズ32等を備えている。

【0178】

前記ビーム整形光学系18は、光源装置16の波長変換部163の波長変換により発生した紫外域の光、（以下、「レーザビーム」と呼ぶ）LBの断面形状を、該レーザビームLBの光路後方に設けられたフライアイレンズ系22に効率良く入射するように整形するもので、例えばシリンドレンズやビームエキスパンダ（いずれも図示省略）等で構成される。

【0179】

前記フライアイレンズ系22は、ビーム整形光学系18から出たレーザビームLBの光路上に配置され、レチクルRを均一な照度分布で照明するために多数の光源像からなる面光源、即ち2次光源を形成する。この2次光源から射出されるレーザビームを本明細書においては、「露光光IL」とも呼んでいる。

【0180】

フライアイレンズ系22の射出面の近傍に、円板状部材から成る照明系開口絞り板24が配置されている。この照明系開口絞り板24には、等角度間隔で、例えば通常の円形開口より成る開口絞り、小さな円形開口より成りコヒーレンスファクタである σ 値を小さくするための開口絞り、輪帯照明用の輪帯状の開口絞り、及び変形光源法用に複数の開口を偏心させて配置して成る変形開口絞り（図1ではこのうちの2種類の開口絞りのみが図示されている）等が配置されている。この照明系開口絞り板24は、主制御装置50により制御されるモータ等の駆動装置40により回転されるようになっており、これによりレチクルパターンに応じていずれかの開口絞りが露光光ILの光路上に選択的に設定される。

【0181】

照明系開口絞り板24から出た露光光ILの光路上に、反射率が小さく透過率

の大きなビームスプリッタ26が配置され、更にこの後方の光路上に、固定レチクルブラインド30A及び可動レチクルブラインド30Bを介在させて第1リレーレンズ28A及び第2リレーレンズ28Bから成るリレー光学系が配置されている。

【0182】

固定レチクルブラインド30Aは、レチクルRのパターン面に対する共役面から僅かにデフォーカスした面に配置され、レチクルR上の照明領域42Rを規定する矩形開口が形成されている。また、この固定レチクルブラインド30Aの近傍に走査方向の位置及び幅が可変の開口部を有する可動レチクルブラインド30Bが配置され、走査露光の開始時及び終了時にその可動レチクルブラインド30Bを介して照明領域42Rを更に制限することによって、不要な部分の露光が防止されるようになっている。

【0183】

リレー光学系を構成する第2リレーレンズ28B後方の露光光ILの光路上には、当該第2リレーレンズ28Bを通過した露光光ILをレチクルRに向けて反射する折り曲げミラーMが配置され、このミラーM後方の露光光ILの光路上にコンデンサレンズ32が配置されている。

【0184】

更に、照明光学系12内のビームスプリッタ26で垂直に折り曲げられる一方の光路上、他方の光路上には、インテグレータセンサ46、反射光モニタ47がそれぞれ配置されている。これらインテグレータセンサ46、反射光モニタ47としては、遠紫外域及び真空紫外域で感度が良く、且つ光源装置16のパルス発光を検出するために高い応答周波数を有するSi系PIN型フォトダイオードが用いられている。なお、インテグレータセンサ46、反射光モニタ47としてGaN系結晶を有する半導体受光素子を用いることも可能である。

【0185】

以上の構成において、フライアイレンズ系22の入射面、可動レチクルブラインド30Bの配置面、レチクルRのパターン面は、光学的に互いに共役に設定され、フライアイレンズ系22の射出面側に形成される光源面、投影光学系PLの

フーリエ変換面（射出瞳面）は光学的に互いに共役に設定され、ケーラー照明系となっている。

【0186】

このようにして構成された照明系12の作用を簡単に説明すると、光源装置16からパルス発光されたレーザビームLBは、ビーム整形光学系18に入射して、ここで後方のフライアイレンズ系22に効率良く入射するようにその断面形状が整形された後、フライアイレンズ系22に入射する。これにより、フライアイレンズ系22の射出側焦点面（照明光学系12の瞳面）に2次光源が形成される。この2次光源から射出された露光光ILは、照明系開口絞り板24上のいずれかの開口絞りを通過した後、透過率が大きく反射率が小さなビームスプリッタ26に至る。このビームスプリッタ26を透過した露光光ILは、第1リレーレンズ28Aを経て固定レチクルブラインド30Aの矩形の開口部及び可動レチクルブラインド30Bを通過した後、第2リレーレンズ28Bを通過してミラーMによって光路が垂直下方に折り曲げられた後、コンデンサレンズ32を経て、レチクルステージRST上に保持されたレチクルR上の矩形の照明領域42Rを均一な照度分布で照明する。

【0187】

一方、ビームスプリッタ26で反射された露光光ILは、集光レンズ44を介してインテグレータセンサ46で受光され、インテグレータセンサ46の光電変換信号が、不図示のピークホールド回路及びA/D変換器を介して出力DS(digit/pulse)として主制御装置50に供給される。このインテグレータセンサ46の出力DSと、ウェハWの表面上での露光光ILの照度（露光量）との相関係数は、予め求められ、主制御装置50に併設された記憶装置としてのメモリ51内に記憶されている。

【0188】

また、レチクルR上の照明領域42Rを照明しそのレチクルのパターン面（図1における下面）で反射された反射光束は、コンデンサレンズ32、リレー光学系を前と逆向きに通過し、ビームスプリッタ26で反射され、集光レンズ48を介して反射光モニタ47で受光される。また、Zチルトステージ58が投影光学

系PLの下方にある場合には、レチクルのパターン面を透過した露光光ILは、投影光学系PL及びウエハWの表面（あるいは後述する基準マーク板FM表面）で反射され、その反射光束は、投影光学系PL、レチクルR、コンデンサレンズ32、リレー光学系を前と逆向きに順次通過し、ビームスプリッタ26で反射され、集光レンズ48を介して反射光モニタ47で受光される。また、ビームスプリッタ26とウエハWとの間に配置される各光学素子はその表面に反射防止膜が形成されているものの、その表面で露光光ILがわずかに反射され、これら反射光も反射光モニタ47で受光される。この反射光モニタ47の光電変換信号が、不図示のピークホールド回路及びA/D変換器を介して主制御装置50に供給される。反射光モニタ47は、本実施形態では、主としてウエハWの反射率の測定等に用いられる。なお、この反射光モニタ47を、レチクルRの透過率の事前測定の際に用いても良い。

【0189】

なお、フライアイレンズ系として、例えば特開平1-235289号公報（対応米国特許第5,307,207号）、特開平7-142354号（対応米国特許第5,534,970号）などに開示されるダブルフライアイレンズ系を採用し、ケーラー照明系を構成しても良い。

【0190】

また、フライアイレンズ系22とともに、回折光学素子（diffractive optical element）を用いても良い。かかる回折光学素子を用いる場合には、光源装置16と照明光学系12とを回折光学素子を介して接続するようにしても良い。

【0191】

すなわち、バンドルーファイバの各ファイバに対応して回折素子が形成される回折光学素子をビーム整形光学系18に設け、各ファイバから出力されるレーザビームを回折させて、フライアイレンズ系22の入射面上で重畠させるようにしても良い。本実施形態では、バンドルーファイバの出力端を照明光学系の瞳面に配置しても良いが、この場合には第1の機能（間引き）によってその瞳面上での強度分布（即ち2次光源の形状や大きさなど）が変化することになり、レチクルパターンに最適な形状、大きさとは異なってしまうことがある。そこで、前述の

回折光学素子などを用いて照明光学系の瞳面、又はオプティカルインテグレータの入射面上で各ファイバからのレーザビームを重畠させるようにすることが望ましい。

【0192】

いずれにしても、本実施形態では、前述した光量制御装置16Cの第1の機能によりバンドルーファイバ173の光を出力する部分の分布が変化した場合であっても、レチクルRのパターン面（物体面）上及びウエハWの面（像面）上のいずれにおいても照度分布の均一性を十分に確保することができる。

【0193】

前記レチクルステージRST上にレチクルRが載置され、不図示のバキュームチャック等を介して吸着保持されている。レチクルステージRSTは、水平面（XY平面）内で微小駆動可能であるとともに、レチクルステージ駆動部49によって走査方向（ここでは図1の紙面左右方向であるY方向とする）に所定ストローク範囲で走査されるようになっている。この走査中のレチクルステージRSTの位置及び回転量は、レチクルステージRST上に固定された移動鏡52Rを介して外部のレーザ干渉計54Rによって計測され、このレーザ干渉計54Rの計測値が主制御装置50に供給されるようになっている。

【0194】

なお、レチクルRに用いる材質は、露光光ILの波長によって使い分ける必要がある。すなわち、波長193nmの露光光を用いる場合には合成石英を用いることができるが、波長157nmの露光光を用いる場合は、ホタル石、フッ素がドープされた合成石英、あるいは水晶などで形成する必要がある。

【0195】

前記投影光学系PLは、例えば両側テレセントリックな縮小系であり、共通のZ軸方向の光軸を有する複数枚のレンズエレメント70a、70b、……から構成されている。また、この投影光学系PLとしては、投影倍率 β が例えば1/4、1/5、1/6などのものが使用されている。このため、前記の如くして、露光光ILによりレチクルR上の照明領域42Rが照明されると、そのレチクルRに形成されたパターンが投影光学系PLによって投影倍率 β で縮小された像が表

面にレジスト（感光剤）が塗布されたウエハW上のスリット状の露光領域42Wに投影され転写される。

【0196】

本実施形態では、上記のレンズエレメントのうち、複数のレンズエレメントがそれぞれ独立に移動可能となっている。例えば、レチクルステージRSTに最も近い一番上のレンズエレメント70aは、リング状の支持部材72により保持され、この支持部材72は、伸縮可能な駆動素子、例えばピエゾ素子74a, 74b, 74c（紙面奥側の駆動素子74cは図示せず）によって、3点支持されるとともに鏡筒部76と連結されている。上記の駆動素子74a, 74b, 74cによって、レンズエレメント70aの周辺3点を独立に、投影光学系PLの光軸AX方向に移動させることができるようにになっている。すなわち、レンズエレメント70aを駆動素子74a, 74b, 74cの変位量に応じて光軸AXに沿って平行移動させるとともに、光軸AXと垂直な平面に対して任意に傾斜させることもできる。そして、これらの駆動素子74a, 74b, 74cに与えられる電圧が、主制御装置50からの指令に基づいて結像特性補正コントローラ78によって制御され、これによって駆動素子74a, 74b, 74cの変位量が制御されるようになっている。なお、図1中、投影光学系PLの光軸AXとは鏡筒部76に固定されているレンズエレメント70bその他のレンズエレメント（図示省略）の光軸を指す。

【0197】

また、本実施形態では、予め実験によりレンズエレメント70aの上下量と倍率（又はディストーション）の変化量との関係を求めておき、これを主制御装置50内部のメモリに記憶しておき、補正時に主制御装置50が補正する倍率（又はディストーション）からレンズエレメント70aの上下量を計算し、結像特性補正コントローラ78に指示を与えて駆動素子74a, 74b, 74cを駆動することにより倍率（又はディストーション）補正を行うようになっている。なお、前記レンズエレメント70aの上下量と倍率等の変化量との関係は光学的な計算値を用いてもよく、この場合は前記レンズエレメント70aの上下量と倍率変化量との関係を求める実験の工程が省けることになる。

【0198】

前記の如く、レチクルRに最も近いレンズエレメント70aが移動可能となっているが、このエレメント70aは倍率、ディストーション特性に与える影響が他のレンズエレメントに比べて大きく制御しやすいものの1つを選択したものであって、同様の条件を満たすものであれば、このレンズエレメント70aに代えてどのレンズエレメントをレンズ間隔調整のために移動可能に構成しても良い。

【0199】

なお、レンズエレメント70a以外の少なくとも1つのレンズエレメントを移動して他の光学特性、例えば像面湾曲、非点収差、コマ収差、又は球面収差などを調整できるようになっている。この他、投影光学系PLの光軸方向中央部近傍の特定のレンズエレメント相互間に密封室を設け、この密封室内の気体の圧力を例えばペローズポンプ等の圧力調整機構により調整することにより、投影光学系PLの倍率を調整する結像特性補正機構を設けても良く、あるいは、例えば、投影光学系PLを構成する一部のレンズエレメントとして非球面状レンズを用い、これを回転させるようにしても良い。この場合には、いわゆるひし形ディストーションの補正が可能になる。あるいは、投影光学系PL内に平行平面板を設け、これをチルトさせたり、回転させたりするような機構により結像特性補正機構を構成しても良い。

【0200】

なお、露光光ILとして波長193nmのレーザ光を用いる場合には、投影光学系PLを構成する各レンズエレメント（及び上記平行平面板）としては合成石英やホタル石等を用いることができるが、波長157nmのレーザ光を用いる場合には、この投影光学系PLに使用されるレンズ等の材質は、全てホタル石が用いられる。

【0201】

また、本実施形態では、チャンバ11の大気圧を測定する大気圧センサ77が設けられている。この大気圧センサ77の計測値は、主制御装置50に供給されるようになっており、主制御装置50では、この大気圧センサ77の計測値に基づいて、標準大気圧からの気圧の変動を算出するとともに、投影光学系PLの

結像特性の大気圧変動を算出する。そして、この大気圧変動分を考慮して結像特性補正コントローラ78に指示を与えて、投影光学系PLの結像特性を補正する。

【0202】

なお、上記の発振波長の変更は、主制御装置50から指示に基づき、レーザ制御装置16Bがビームモニタ機構164を構成するエタロン素子の温度を積極的に制御して、エタロン素子の透過率が最大となる共鳴波長（検出基準波長）が一致している設定波長（目標波長）を変更すると共に、この変更後の設定波長にDFB半導体レーザ160Aの発振波長が一致するように、DFB半導体レーザ160Aの温度をフィードバック制御することにより容易に達成される。

【0203】

なお、主制御装置50による結像特性の大気圧変動分、照射変動分等の演算法等については、例えば特開平9-213619号公報等に詳細に開示されており、公知であるから、ここでは詳細な説明は省略する。

【0204】

前記XYステージ14は、ウェハステージ駆動部56によって走査方向であるY方向及びこれに直交するX方向（図1における紙面直交方向）に2次元駆動されるようになっている。このXYステージ14上に搭載されたZチルトステージ58上に不図示のウェハホルダ61を介してウェハWが真空吸着等により保持されている。Zチルトステージ58は、例えば3つのアクチュエータ（ピエゾ素子又はボイスコイルモータなど）によってウェハWのZ方向の位置（フォーカス位置）を調整すると共に、XY平面（投影光学系PLの像面）に対するウェハWの傾斜角を調整する機能を有する。また、XYステージ14の位置は、Zチルトステージ58上に固定された移動鏡52Wを介して外部のレーザ干渉計54Wにより計測され、このレーザ干渉計54Wの計測値が主制御装置50に供給されるようになっている。

【0205】

ここで、移動鏡は、実際には、X軸に垂直な反射面を有するX移動鏡とY軸に垂直な反射面を有するY移動鏡とが存在し、これに対応してレーザ干渉計もX軸

位置計測用、Y軸位置計測用、及び回転（ヨーイング量、ピッティング量、ローリング量を含む）計測用のものがそれぞれ設けられているが、図1では、これらが代表的に、移動鏡52W、レーザ干渉計54Wとして示されている。

【0206】

また、Zチルトステージ58上には、ウエハWの近傍に、ウエハWの露光面と同じ高さの受光面を有し、投影光学系PLを通過した露光光ILの光量を検出するための照射量モニタ59が設けられている。照射量モニタ59は、露光領域42Wより一回り大きなX方向に延びる平面視長方形のハウジングを有し、このハウジングの中央部に露光領域42Wとほぼ同じ形状のスリット状の開口が形成されている。この開口は、実際にはハウジングの天井面を形成する合成石英等から成る受光ガラスの上面に形成された遮光膜の一部が取り除かれて形成されている。前記開口の真下にレンズを介してSi系PIN型フォトダイオード等の受光素子を有する光センサが配置されている。

【0207】

照射量モニタ59は、露光領域42Wに照射される露光光ILの強度測定に用いられる。照射量モニタ59を構成する受光素子の受光量に応じた光量信号が主制御装置50に供給されるようになっている。

【0208】

なお、光センサは、必ずしもZチルトステージ58の内部に設ける必要はなく、Zチルトステージ58の外部に光センサを配置し、リレー光学系でリレーされた照明光束を光ファイバ等を介してその光センサに導くようにしても良いことは勿論である。

【0209】

Zチルトステージ58上には、後述するレチクルアライメント等を行う際に使用される基準マーク板FMが設けられている。この基準マーク板FMは、その表面がウエハWの表面とほぼ同一の高さとされている。この基準マーク板FMの表面には、レチクルアライメント用基準マーク、ベースライン計測用基準マーク等の基準マークが形成されている。

【0210】

また、図1では図面の錯綜を避ける観点から図示が省略されているが、この露光装置10は、実際にはレチクルアライメントを行うためのレチクルアライメント系を備えている。

【0211】

レチクルRのアライメントを行う場合には、まず主制御装置50によりレチクルステージ駆動部49、ウエハステージ駆動部56を介してレチクルステージR ST及びXYステージ14が駆動され、矩形の露光領域42W内に基準マーク板FM上のレチクルアライメント用基準マークが設定され、その基準マークにレチクルR上のレチクルマーク像がほぼ重なるようにレチクルRとZチルトステージ58との相対位置が設定される。この状態で、主制御装置50によりレチクルアライメント系を用いて両マークが撮像され、主制御装置50では、その撮像信号を処理して対応する基準マークに対するレチクルマークの投影像のX方向、Y方向の位置ずれ量を算出する。

【0212】

また、上記のレチクルのアライメントの結果得られた基準マークの投影像の検出信号（画像信号）に含まれるコントラスト情報に基づいてフォーカスオフセットやレベリングオフセット（投影光学系PLの焦点位置、像面傾斜など）を求めることも可能である。

【0213】

また、本実施形態では、上記のレチクルアライメント時に、主制御装置50によって、投影光学系PLの側面に設けられた不図示のウエハ側のオフアクシス・アライメントセンサのベースライン量の計測も行われる。すなわち、基準マーク板FM上には、レチクルアライメント用基準マークに対して所定の位置関係でベースライン計測用基準マークが形成されており、レチクルアライメント系を介してレチクルマークの位置ずれ量を計測する際に、そのウエハ側のアライメントセンサを介してベースライン計測用基準マークのそのアライメントセンサの検出中心に対する位置ずれ量を計測することで、アライメントセンサのベースライン量、すなわちレチクル投影位置とアライメントセンサとの相対位置関係が計測される。

【0214】

更に、本実施形態の露光装置10では、図1に示されるように、主制御装置50によってオン・オフが制御される光源を有し、投影光学系PLの結像面に向けて多数のピンホールまたはスリットの像を形成するための結像光束を、光軸AXに対して斜め方向より照射する照射光学系60aと、それらの結像光束のウエハW表面での反射光束を受光する受光光学系60bとからなる斜入射光式の多点焦点位置検出系（フォーカスセンサ）が設けられている。主制御装置50では、受光光学系60b内の図示しない平行平板の反射光束の光軸に対する傾きを制御することにより、投影光学系PLのフォーカス変動に応じて焦点検出系（60a、60b）にオフセットを与えてそのキャリブレーションを行う。これにより、前述の露光領域42W内で投影光学系PLの像面とウエハWの表面とがその焦点深度の範囲（幅）内で合致することになる。なお、本実施形態と同様の多点焦点位置検出系（フォーカスセンサ）の詳細な構成は、例えば特開平6-283403号公報等に開示されている。

【0215】

走査露光時等に、主制御装置50では、受光光学系60bからの焦点ずれ信号（デフォーカス信号）、例えばSカーブ信号に基づいて焦点ずれが零となるよう¹にZチルトステージ58のZ位置を不図示の駆動系を介して制御することにより、オートフォーカス（自動焦点合わせ）及びオートレベリングを実行する。

【0216】

なお、受光光学系60b内に平行平板を設けて焦点検出系（60a、60b）にオフセットを与えるようにしたのは、例えば、倍率補正のためにレンズエレメント70aを上下することによりフォーカスも変化し、また、投影光学系PLが露光光ILを吸収することにより結像特性が変化して結像面の位置が変動するので、かかる場合に焦点検出系にオフセットを与え、焦点検出系の合焦位置を投影光学系PLの結像面の位置に一致させる必要があるためである。このため、本実施形態では、レンズエレメント70aの上下量とフォーカス変化量の関係も予め実験により求め、主制御装置50内部のメモリに記憶している。なお、レンズエレメント70aの上下量とフォーカス変化量の関係は計算値を用いても良い。ま

た、オートレベリングでは走査方向については行わず、その走査方向と直交する非走査方向のみに関して行うようにしても良い。

【0217】

前記主制御装置50は、CPU（中央演算処理装置）、ROM（リード・オン・メモリ）、RAM（ランダム・アクセス・メモリ）等から成るいわゆるマイクロコンピュータ（又はワークステーション）を含んで構成され、これまでに説明した各種の制御を行う他、露光動作が的確に行われるよう、例えばレチクルRとウエハWの同期走査、ウエハWのステッピング、露光タイミング等を制御する。また、本実施形態では、主制御装置50は、後述するように走査露光の際の露光量の制御を行ったり、投影光学系PLの結像特性の変動量を演算にて算出し、その算出結果に基づいて結像特性補正コントローラ78を介して投影光学系PLの結像特性を調整する等の他、装置全体を統括制御する。

【0218】

具体的には、主制御装置50は、例えば走査露光時には、レチクルRがレチクルステージRSTを介して+Y方向（又は-Y方向）に速度 $V_R = V$ で走査されるのに同期して、XYステージ14を介してウエハWが露光領域42Wに対して-Y方向（又は+Y方向）に速度 $V_W = \beta \cdot V$ （ β はレチクルRからウエハWに対する投影倍率）で走査されるように、レーザ干渉計54R、54Wの計測値に基づいてレチクルステージ駆動部49、ウエハステージ駆動部56をそれぞれ介してレチクルステージRST、XYステージ14の位置及び速度をそれぞれ制御する。また、ステッピングの際には、主制御装置50ではレーザ干渉計54Wの計測値に基づいてウエハステージ駆動部56を介してXYステージ14の位置を制御する。

【0219】

次に、本実施形態の露光装置10において所定枚数（N枚）のウエハW上にレチクルパターンの露光を行う場合の露光シーケンスについて主制御装置50の制御動作を中心として説明する。

【0220】

まず、前提条件について説明する。

① オペレータによりコンソール等の入出力装置62（図1参照）から入力されたショット配列、ショットサイズ、各ショットの露光順序その他の必要なデータに基づいて、予めショットマップデータ（各ショット領域の露光順序と走査方向とを定めたデータ）が作成され、メモリ51（図1参照）内に格納されているものとする。

② また、インテグレータセンサ46の出力は、Zチルトステージ58上で像面（即ち、ウェハの表面）と同じ高さに設置された不図示の基準照度計の出力に対して予め較正（キャリブレーション）されているものとする。インテグレータセンサ46の較正とは、インテグレータセンサ46の出力を、像面上の露光量に変換するための変換係数（或いは変換関数）を得ることである。この変換係数を用いると、インテグレータセンサ46の出力より間接的に像面上に与えられている露光量（エネルギー）を計測できることになる。

③ また、上記キャリブレーションが完了したインテグレータセンサ46の出力に対して、ビームモニタ機構164内のエネルギーモニタ、光増幅部161内の光電変換素子180、181及び波長変換部163内の光電変換素子182等の出力もキャリブレーションされ、インテグレータセンサ46の出力に対する各センサ出力の相関係数も予め求められ、メモリ51内に格納されている。

④ さらに、上記キャリブレーションが完了したインテグレータセンサ46の出力に対して反射光モニタ47の出力がキャリブレーションされ、インテグレータセンサ46の出力と反射光モニタ47の出力との相関係数が予め求められてメモリ51内に格納されているものとする。

【0221】

まず、オペレータによりコンソール等の入出力装置62（図1参照）から照明条件（投影光学系の開口数N.A.、2次光源の形状（開口絞り24の種類）、コヒーレンスファクタ α やレチクルパターンの種類（コンタクトホール、ラインアンドスペース等）、レチクルの種類（位相差レチクル、ハーフトーンレチクル等）、及び最小線幅又は露光量許容誤差など）を含む露光条件が入力され、この入力に応じて、主制御装置50が、投影光学系PLの不図示の開口絞りの設定、照明系開口絞り板24の開口の選択設定、レジスト感度に応じた目標積算露光量

(設定光量に対応する量である)の設定等を行う。このとき、同時に主制御装置50では、目標積算露光量を得るために光源装置16からの出力光量を設定光量にほぼ一致させるための、バンドルファイバ173の出力をオン、及びオフにすべきチャネルの選択を行い、この選択指令を光量制御装置に与える。これにより、後述する走査露光の際にレーザ光源160Aの発光とほぼ同時に、光量制御装置16Cにより、前述した第1の機能により選択指令に応じて各チャネルのファイバ増幅器171_nのオン・オフが実行され、露光量の粗調整が実行されることとなる。

【0222】

次に、主制御装置50では、不図示のレチクルローダを用いて露光対象のレチクルRをレチクルステージRST上にロードする。

【0223】

次いで、前述した如く、レチクルアライメント系を用いてレチクルアライメントを行うとともに、ベースライン計測を行う。

【0224】

次に、主制御装置50では、不図示のウエハ搬送系にウエハWの交換を指示する。これにより、ウエハ搬送系及びXYステージ14上の不図示のウエハ受け渡し機構によってウエハ交換（ステージ上にウエハが無い場合は、単なるウエハロード）が行われ、次いでいわゆるサーチアライメント及びファインアライメント（EGA等）の一連のアライメント工程の処理を行う。これらのウエハ交換、ウエハアライメントは、公知の露光装置と同様に行われる所以、ここではこれ以上の詳細な説明は省略する。

【0225】

次に、上記のアライメント結果及びショットマップデータに基づいて、ウエハW上の各ショット領域の露光のための走査開始位置にウエハWを移動させる動作と、前述した走査露光動作とを繰り返し行って、ステップ・アンド・スキャン方式でウエハW上の複数のショット領域にレチクルパターンを転写する。この走査露光中に、主制御装置50では、露光条件及びレジスト感度に応じて決定された目標積算露光量をウエハWに与えるため、インテグレータセンサ46の出力をモ

ニタしつつ光量制御装置16Cに指令を与える。これにより、光量制御装置16Cでは、前述した第1の機能により露光量の粗調整を行うとともに、前述した第2の機能、第3の機能により、光源装置16からのレーザビーム（紫外パルス光）の周波数及びピークパワーを制御し、露光量の微調整を実行する。

【0226】

また、主制御装置50では、照明系開口絞り板24を駆動装置40を介して制御し、更にステージ系の動作情報に同期して可動レチクルブラインド30Bの開閉動作を制御する。

【0227】

1枚目のウエハWに対する露光が終了すると、主制御装置50では、不図示のウエハ搬送系にウエハWの交換を指示する。これにより、ウエハ搬送系及びXYステージ14上の不図示のウエハ受け渡し機構によってウエハ交換が行われ、以後上記と同様にしてその交換後のウエハに対してサーチアライメント、ファインアライメントを行う。また、この場合、主制御装置50により1枚目のウエハWに対する露光開始からの投影光学系PLの結像特性（フォーカスの変動を含む）の照射変動が、インテグレータセンサ46及び反射光モニタ47の計測値に基づいて求められ、この照射変動を補正するような指令値を結像特性補正コントローラ78に与えるとともに受光光学系60bにオフセットを与える。また、主制御装置50では、大気圧センサ77の計測値に基づいて、投影光学系PLの結像特性の大気圧変動分も求めて、この照射変動を補正するような指令値を結像特性補正コントローラ78に与えるとともに受光光学系60bにオフセットを与える。

【0228】

そして、上記と同様に、このウエハW上の複数のショット領域にステップ・アンド・スキャン方式でレチクルパターンを転写する。

【0229】

この場合、前述した露光量（光量）の粗調整を、実露光前にテスト発光を行い、露光量設定値に対し、1%以下の精度で制御を確実に行うようにしても良い。

【0230】

本実施形態の露光量の粗調整のダイナミックレンジは、1～1／128の範囲

内で設定可能であるが、通常要求されるダイナミックレンジは、典型的には1／1／7程度であるため、光出力をオンにすべきチャネル数（光ファイバ数）を128～18の間で制御することによって行えば良い。このように、本実施形態では、各チャネルの光出力の個別オン・オフによる露光量制御により、ウエハ毎のレジスト感度等の違いにあわせた露光量の粗調整を正確に行うことができる。

【0231】

従って、本実施形態では、従来のエキシマレーザ露光装置に用いられていたNDフィルタ等のエネルギー粗調器が不要となる。

【0232】

また、上述した光量制御装置16Cによる、第2、第3の機能による光量制御は、制御速度が速く、制御精度が高いという特徴を持つため、以下の現状の露光装置に要求されている制御要請を確実に満たすことが可能である。

【0233】

すなわち、同一ウエハ内における、例えばレジストの膜厚のばらつきに起因して生じる、ショット領域（チップ毎）のプロセスばらつきを補正する露光量制御のための要請である、ダイナミックレンジが設定露光量の±10%程度、ショット間ステッピング時間である100ms程度の時間内に設定値に制御すること、制御精度として設定露光量の±1%程度、1ショット領域の線幅均一性を実現するための露光制御のための要請である、制御精度として典型的には1ショットの露光時間である20ms/secの時間内に設定露光量の±0.2%に設定すること、制御速度1ms程度、の全てを満たす。

【0234】

従って、露光量制御のためには、光量制御装置16Cでは、第2、第3の機能による光量制御の少なくとも一方を行えば足りる。

【0235】

また、本実施形態の露光装置10のようなレーザ光源（パルス光源）を有する走査型露光装置では、ウエハWの走査速度（スキャン速度）をV_w、ウエハW上のスリット状の露光領域42Wの走査方向の幅（スリット幅）をD、レーザ光源のパルスの繰り返し周波数をFとすると、パルス発光間にウエハWが移動する間

隔は V_W/F であるため、ウエハ上の 1 点当たりに照射すべき露光光 IL のパルス数（露光パルス数）N は次式（3）で表される。

【0236】

$$N = D / (V_W / F) \quad \dots \dots (3)$$

【0237】

パルスエネルギーを P とすると、単位時間にウエハ上の 1 点当たりに与えられるべきエネルギーは、次式（4）で表される。

【0238】

$$E = NP = ND / (V_W / F) \quad \dots \dots (4)$$

【0239】

従って、走査型露光装置では、スリット幅 D、スキャン速度 V_W 、レーザ光源のパルスの繰り返し周波数 F、パルスエネルギー P のいずれかを制御することにより、露光量（積算露光量）の制御が可能である。応答速度の問題から走査露光中にスリット幅 D を調整することには難点があるので、スキャン速度 V_W 、レーザ光源のパルスの繰り返し周波数 F、パルスエネルギー P のいずれかを制御すれば良い。

【0240】

従って、本実施形態の露光装置 10においても、光量制御装置 16C の第 2、第 3 の機能による光量制御のいずれかと、スキャン速度とを組み合わせて、露光量を制御するようにしても、勿論良い。

【0241】

例えば、ウエハ W 上に転写すべきレチクルパターンに応じてウエハ W の露光条件を変更する、例えば照明光学系の瞳面上での照明光の強度分布（即ち 2 次光源の形状や大きさ）を変化させたり、あるいは投影光学系 PL のほぼ瞳面上でその光軸を中心とする円形領域を遮光する光学フィルタを挿脱する。この露光条件の変更によってウエハ W 上での照度が変化するが、このことはレチクルパターンの変更によても生じる。これは、パターンの遮光部（又は透過部）の占有面積の違いによるものである。そこで、露光条件及びレチクルパターンの少なくとも一方の変更によって照度が変化するときは、ウエハ（レジスト）に適正な露光量が

与えられるように、前述した周波数とピークパワーとの少なくとも一方を制御することが望ましい。このとき、周波数及びピークパワーの少なくとも一方に加えてレチクル及びウエハの走査速度を調整するようにしても良い。

【0242】

以上詳細に説明したように、本実施形態に係る光源装置16によると、光発生部160で発生した単一波長のレーザ光が遅延部167を介してその出力段に並列に設けられた総計128の光ファイバ（光経路172_n）のそれぞれに向かって進むが、光量制御装置16Cでは各光経路172_nからの光出力を個別にオン・オフすることにより、ファイバ群（光経路172_nの全体）から出力される光の光量を制御する。このように本実施形態では、各光経路172_nの光出力を個別にオン・オフするという簡単な手法により光経路172_nの全体から出力される光の光量制御を実現することができる。

【0243】

また、この場合、光経路の数に比例した128段階の光量制御が可能となるので、広いダイナミックレンジを容易に実現することができる。また、各光経路の諸性能がほぼ同じであるため、光経路のそれぞれからの同一光量の光を出力させることができる。この結果、光経路の数に応じた128段階の光量制御をリニアリティ良く実行することができる。この場合、1%刻み以下の精度で光量を制御することができる。

【0244】

また、これにより前述の如く、NDフィルタ等のエネルギー粗調器は不要となるので、該フィルタの耐久性、透過率の計時変化等に起因する光量制御性能の劣化等の諸問題も改善できる。

【0245】

また、各光経路を構成するファイバ増幅器171_nは、それぞれの出力端部が束ねられてバンドルーファイバ173が構成されており、該バンドルーファイバ173全体の直径が2mm以下となっている。そのため、出力段に配置される四分の一波長板162、及び波長変換部163を構成する非線形光学結晶等の光学素子として小型の光学素子を用いることができる。

【0246】

また、各光経路 172_n の一部には、ファイバ増幅器 168_n 、 171_n が設けられ、光量制御装置 $16C$ は、各光経路 172_n の光出力のオン・オフを最終段のファイバ増幅器 171_n の励起用半導体レーザ 174 からの励起光の強度の切り換えにより行うようになっている。このため、ファイバ増幅器 168_n 、 171_n により光経路 172_n に入射した光を増幅できるとともに、光出力をオフすることとされた光経路 172_n に設けられたファイバ増幅器 171_n に対する励起光の強度レベルが低く（零を含む）設定されるので、その分省エネが可能である。また、ファイバ増幅器の励起用半導体レーザ 174 からの励起光の強度の切り換えにより光出力のオン・オフを行うので、シャッタ等を用いる場合に比べて短時間で光出力のオン・オフが可能である。

【0247】

また、光経路 172_n からの光出力のオン・オフを最終段のファイバ増幅器 171_n の励起用半導体レーザ 174 からの励起光の強度の切り換えにより行うことから、最終段以外のファイバ増幅器の励起用光源からの励起光の強度を切り換える場合に問題となるASEの悪影響を回避することができる。また、ファイバ増幅器 171_n は最も大きな励起光の強度を必要とするので、ファイバ増幅器 171_n からの光出力をオフしたときの省エネの効果が一層大きくなる。

【0248】

また、この最終段のファイバ増幅器 171_n は、ファイバ増幅器 168_n に比べてモードフィールド径が大きいものが用いられているので、光ファイバ中の非線形効果による増幅光のスペクトル幅の増加を避けることができる。

【0249】

また、メモリ 51 内に光経路 172_n からの光出力のオン・オフ状況に対応する第1の出力強度マップが予め記憶され、光量制御装置 $16C$ は、第1の出力強度マップと所定の設定光量に基づいて各光経路 172_n からの光出力を個別にオン・オフするようになっている。このため、各光経路 172_n の出力にばらつきがあっても光経路全体の光出力を設定光量にほぼ一致させることができるとともに、諸性能の異なる構成部材を用いて光経路を構成することも可能である。す

なわち、諸性能（ファイバ径等を含む）の異なる光ファイバ等を用いることが可能となる。

【0250】

また、第1の出力強度マップは、予め実際に測定された各光経路の出力のばらつきに基づいて作成されているので、光経路全体の光出力を設定光量に確実に一致させることができる。

【0251】

また、本実施形態の光源装置16では、各光経路 172_n から出力される光の波長を変換する波長変換部163を備えているが、波長変換部163の出力は、光出力がオンである光経路数（チャネル数）に比例する。このため、光経路の諸性能がほぼ同じである場合には、光経路 172_n のそれからの同一光量の光を出力させることができるので、ニアリティ良く光量を制御することができる。

【0252】

また、第1の出力強度マップは、予め測定された各光経路出力に対応する波長変換効率のばらつきに起因する出力のばらつきをも考慮して作成されているので、各光経路からの光出力に対する波長変換効率にはばらつきがあっても、出力光の光量を設定光量に制御することができる。

【0253】

また、本実施形態に係る光源装置16は、複数の光経路それからの光出力を個別に遅延させて、光出力を時間的にずらして行わせる遅延部167を備えているので、各光経路から出力される光が時間的に重なることがなくなるので、結果的に該光源装置16からの出力光は、極めて狭帯域化された单一波長の光でありながら、お互いに時間的に重なり合うことがなく、各チャネル出力間の空間的コヒーレンスを低減することができる。

【0254】

また、本実施形態に係る光源装置16によると、光量制御装置16CがEOM160Cから出力されるパルス光の周波数を制御することにより、光増幅部161を構成するファイバ増幅器からの出力光の光量を設定光量（目標光量）に一致させることができる。このパルス光の周波数（単位時間当たりのパルス数）制御

による光量調整では、前述した光経路からの光出力の個別オン・オフに比べて、より高速にかつより細やかな光量調整を行うことが可能となり、設定光量が所定範囲内にあれば如何なる値に設定されても光量をほぼ一致させることができる。また、光出力と制御量とのリニアリティも良い。

【0255】

また、光増幅部161に入力するパルス光の周波数に応じた光増幅部161の出力強度に基づく第2の出力強度マップがメモリ51内に記憶され、光量制御装置16Cは、第2の出力強度マップと所定の設定光量とに基づいてEOM160Cから出力されるパルス光の周波数を制御する。このため、光増幅部161を構成するファイバ増幅器の利得の入力光強度依存性に起因する光増幅部161からの出力パルスのピークパワー変化の影響を受けることのない、高精度な光量制御が可能となる。

【0256】

また、本実施形態に係る光源装置16によると、光量制御装置16CがEOM160Cから出力されるパルス光のピークパワーを制御することにより、光増幅部161を構成するファイバ増幅器からの出力光の光量を設定光量（目標光量）に一致させることができる。このパルス光のピークパワー制御による光量調整では、前述した光経路からの光出力の個別オン・オフに比べて、より高速にかつより細やかな光量調整を行うことが可能となり、設定光量が所定範囲内にあれば如何なる値に設定されても光量をほぼ一致させることができる。

【0257】

また、光増幅部161に入力するパルス光の強度に応じた光増幅部161の出力強度に基づく第3の出力強度マップがメモリ51に記憶され、光量制御装置16Cは、第3の出力強度マップと所定の設定光量とに基づいてEOM160Cから出力されるパルス光のピークパワーを制御するので、光増幅部161を構成するファイバ増幅器の利得の入力光強度依存性に起因する光増幅部161からの出力パルスのピークパワー変化の影響を受けることのない、高精度な光量制御が可能となる。

【0258】

また、本実施形態の光量制御装置16Cは、前述の如く、光経路からの光出力の個別オン・オフによる光量制御機能（第1の機能）と、EOM160Cから出力されるパルス光の周波数制御による光量制御機能（第2の機能）と、EOM160Cから出力されるパルス光のピークパワー制御による光量制御機能（第3の機能）とを有しているので、第1の機能と、第2の機能及び第3の機能の少なくとも一方とにより、光経路172_nの光出力の個別オン・オフによる段階的な光量制御に加えて、各段階間の光量の微調整がEOM160Cから出力されるパルス光の周波数及びピークパワーの少なくとも一方の制御により可能になるので、結果的に光量の連続制御が可能となり、所定範囲内であれば設定光量が如何なる値に設定されても、出力光の光量をその設定光量に一致させることができるものである。

【0259】

また、光量制御装置16Cでは、第2の機能と第3の機能とにより、EOM160Cから出力されるパルス光の周波数制御に加えてピークパワーを更に制御することができるので、パルス光のピークパワーに変動があるような場合であっても、精度の良い光量制御が可能となる。

【0260】

しかしながら、本発明がこれに限定されるものではなく、本発明に係る光源装置を構成する光量制御装置は、上記第1～第3の機能の少なくとも一つのみを有していても良い。

【0261】

また、本実施形態に係る露光装置10によると、照明光学系12により光源装置16の波長変換部163から出力される紫外光（波長193nm又は157nm）を露光用照明光としてレチクルRが照明され、該レチクルRに形成されたパターンがウエハW上に転写される。この場合、光源装置16により、レチクルRに照射される紫外光の光量制御を必要な要請に応じて行うことができるので、結果的に要求される露光量制御を実現することができる。

【0262】

また、露光装置10によると、光発生部160では、光源160Aで発生した

单一波長の光をEOM160Cによりパルス光に変換することによりパルス光を発生し、そのパルス光がファイバ増幅器を含む光増幅部161によって増幅される。そして、主制御装置50により、その増幅されたパルス光をレチクルRに照射して、該レチクルを介してウエハWを露光する際に、その露光対象領域のウエハ上の位置、すなわち各ショット領域のウエハ上の位置又は各ショット領域内のスリット状照明領域で照明される領域の位置に応じてEOM160Cを介してパルス光の周波数及びピークパワーの少なくとも一方が光量制御装置16Cを介して制御され、これによりレチクルRに照射される光量、ひいてはウエハの露光量が高精度に制御される。従って、ウエハ上の露光対象領域の位置によらず、常に適切な露光量制御が可能となり、精度良くレチクルRのパターンをウエハW上に転写することが可能になる。すなわち、ウエハ上の各ショット領域毎のプロセスばらつきの補正や各ショット領域内の線幅均一性の向上が可能になる。

【0263】

また、本実施形態に係る露光装置によると、主制御装置50により、前記の如く、増幅されたパルス光をレチクルRに照射して、該レチクルRを介してウエハWを露光する際に、各光経路 172_n からの光出力を個別にオン・オフすることにより光増幅部161から出力されるパルス光の光量が光量制御装置16Cを介して制御され、これによりレチクルRに照射される光量、ひいてはウエハの露光量が広い範囲に渡って段階的に制御される。従って、複数枚のウエハを繰り返し露光する際のウエハ毎のレジスト感度等の違いに合わせた露光量制御が可能になる。従って、レジスト感度等に影響を受けることなく、ウエハ上にレチクルパターンを要求される精度で転写することが可能になる。

【0264】

なお、上記実施形態では、各光経路（各チャネル）からの光出力をオン・オフする際に、ファイバ増幅器の励起光の強度を切り換えることにより行う場合について説明したが、本発明がこれに限定されるものではなく、例えば、各光経路に対する入射光を遮光する機械的又は電気的なシャッタ、あるいは各光経路からの光の出射を阻止する機械的又は電気的なシャッタを設ける等種々考えられる。

【0265】

また、上記実施形態では、光増幅部161が128チャネルの光経路を有する場合について説明したが、光増幅部は1チャネルであっても良く、かかる場合であっても、前述したEOM等の光変調器から出力されるパルス光の周波数制御、ピークパワー制御による光量、露光量の制御は好適に適用できる。

【0266】

なお、上記実施形態では、バンドルーファイバを形成するファイバの本数を128本としたが、その本数は任意でよく、本発明に係る光源装置が適用される製品、例えば露光装置で要求される仕様（ウエハ上の照度）、及び光学性能、即ち照明光学系や投影光学系の透過率、波長変換部の変換効率、及び各ファイバの出力などに応じてその本数を決定すればよい。さらに上記実施形態では、紫外光の波長を、ArFエキシマレーザ又はF₂レーザの波長とほぼ同一に設定するものとしたが、その設定波長は任意で良く、この設定すべき波長に応じて、レーザ光源160Aの発振波長や波長変換部の構成及び高調波の倍率などを決定すれば良い。なお、設定波長は、一例として、ウエハ上に転写すべきパターンのデザインルール（線幅、ピッチなど）に応じて決定するようにしても良く、更にはその決定に際して前述の露光条件やレチクルの種類（位相シフト型か否か）などを考慮しても良い。

【0267】

なお、上記実施形態では、レーザ光源160Aの発振波長の制御のため、レーザ光源160Aの直後でそのレーザ光をビームモニタ機構164によりモニタするものとしたが、これに限らず、例えば図5中に点線で示されるように、波長変換部163内（あるいは波長変換部163の後方）で光束を分岐して、これをビームモニタ機構164と同様のビームモニタ機構183でモニタするようにしても良い。そして、このビームモニタ機構183によるモニタ結果に基づいて、波長変換が正確に行われているか否かを検出し、この検出結果に基づいて主制御装置50がレーザ制御装置16Bをフィードバック制御するようにしても良い。勿論、両方のビームモニタ機構のモニタ結果を用いてレーザ光源160Aの発振波長制御を行っても良い。

【0268】

また、上記実施形態中では特に説明をしなかったが、本実施形態のように、193 nm以下の露光波長により露光を行う装置の場合には、光束通過部分にはケミカルフィルタを通過したクリーンエアーや、ドライエアー、N₂ガス、若しくはヘリウム、アルゴン、クリプトン等の不活性ガスを充填させあるいはフローさせたり、該光束通過部分を真空にする等の処置が必要となる。

【0269】

上記実施形態の露光装置は、本願の特許請求の範囲に挙げられた各構成要素を含む各種サブシステムを、所定の機械的精度、電気的精度、光学的精度を保つよう、組み立てることで製造される。これら各種精度を確保するために、この組み立ての前後には、各種光学系については光学的精度を達成するための調整、各種機械系については機械的精度を達成するための調整、各種電気系については電気的精度を達成するための調整が行われる。各種サブシステムから露光装置への組み立て工程は、各種サブシステム相互の、機械的接続、電気回路の配線接続、気圧回路の配管接続等が含まれる。この各種サブシステムから露光装置への組み立て工程の前に、各サブシステム個々の組み立て工程があることは言うまでもない。各種サブシステムの露光装置への組み立て工程が終了したら、総合調整が行われ、露光装置全体としての各種精度が確保される。なお、露光装置の製造は温度およびクリーン度等が管理されたクリーンルームで行うことが望ましい。

【0270】

また、上記実施形態では、本発明に係る光源装置がステップ・アンド・スキャン方式の走査型露光装置に適用された場合について説明したが、露光装置以外の装置、例えば、ウエハ上に形成された回路パターンの一部（ヒューズなど）を切断するために用いられるレーザリペア装置などにも本発明に係る光源装置を適用することができる。また、本発明に係る光源装置は可視光または赤外光を用いる検査装置などにも適用することができる。そしてこの場合には前述の波長変換部を光源装置に組み込む必要がない。すなわち、本発明は紫外レーザ装置だけでなく、可視域または赤外域の基本波を発生する、波長変換部がないレーザ装置に対しても有効なものである。また、本発明は、ステップ・アンド・スキャン方式の走査型露光装置に限らず、静止露光型、例えばステップ・アンド・リピート方式

の露光装置（ステッパなど）にも好適に適用できるものである。更にはステップ・アンド・スティッチ方式の露光装置、ミラープロジェクション・アライナーなどにも適用できる。

【0271】

なお、上記実施形態で示した投影光学系や、照明光学系はほんの一例であって、本発明がこれに限定されることは勿論である。例えば、投影光学系として屈折光学系に限らず、反射光学素子のみからなる反射系、又は反射光学素子と屈折光学素子とを有する反射屈折系（カタッディオプトリック系）を採用しても良い。波長200nm程度以下の真空紫外光（VUV光）を用いる露光装置では、投影光学系として反射屈折系を用いることも考えられる。この反射屈折型の投影光学系としては、例えば特開平8-171054号公報及び特開平10-20195号公報などに開示される、反射光学素子としてビームスプリッタと凹面鏡とを有する反射屈折系、又は特開平8-334695号公報及び特開平10-3039号公報などに開示される、反射光学素子としてビームスプリッタを用いずに凹面鏡などを有する反射屈折系を用いることができる。

【0272】

この他、米国特許第5,488,229号、及び特開平10-104513号公報に開示される、複数の屈折光学素子と2枚のミラー（凹面鏡である主鏡と、屈折素子又は平行平面板の入射面と反対側に反射面が形成される裏面鏡である副鏡）と同一軸上に配置し、その複数の屈折光学素子によって形成されるレチクルパターンの中間像を、主鏡と副鏡とによってウエハ上に再結像させる反射屈折系を用いても良い。この反射屈折系では、複数の屈折光学素子に続けて主鏡と副鏡とが配置され、照明光が主鏡の一部を通って副鏡、主鏡の順に反射され、さらに副鏡の一部を通ってウエハ上に達することになる。

【0273】

また、上記実施形態では、オプティカルインテグレータ（ホモジナイザ）としてフライアイレンズ系を用いるものとしたが、その代わりにロッド・インテグレータを用いるようにしてもよい。ロッド・インテグレータを用いる照明光学系では、ロッド・インテグレータはその射出面がレチクルRのパターン面とほぼ共役

になるように配置されるので、例えばロッド・インテグレータの射出面に近接して前述の固定レチクルブラインド30Aや可動レチクルブラインド30Bを配置しても良い。

【0274】

勿論、半導体素子の製造に用いられる露光装置だけでなく、液晶表示素子などを含むディスプレイの製造に用いられる、デバイスパターンをガラスプレート上に転写する露光装置、薄膜磁気ヘッドの製造に用いられる、デバイスパターンをセラミックウエハ上に転写する露光装置、及び撮像素子（CCDなど）の製造に用いられる露光装置などにも本発明を適用することができる。

【0275】

《デバイス製造方法》

【0276】

次に、上述した露光装置をリソグラフィ工程で使用したデバイスの製造方法の実施形態について説明する。

【0277】

図7には、デバイス（ICやLSI等の半導体チップ、液晶パネル、CCD、薄膜磁気ヘッド、マイクロマシン等）の製造例のフローチャートが示されている。図7に示されるように、まず、ステップ201（設計ステップ）において、デバイスの機能・性能設計（例えば、半導体デバイスの回路設計等）を行い、その機能を実現するためのパターン設計を行う。引き続き、ステップ202（マスク製作ステップ）において、設計した回路パターンを形成したマスクを製作する。一方、ステップ203（ウエハ製造ステップ）において、シリコン等の材料を用いてウエハを製造する。

【0278】

次に、ステップ204（ウエハ処理ステップ）において、ステップ201～ステップ203で用意したマスクとウエハを使用して、後述するように、リソグラフィ技術等によってウエハ上に実際の回路等を形成する。次いで、ステップ205（デバイス組立ステップ）において、ステップ204で処理されたウエハを用いてデバイス組立を行う。このステップ205には、ダイシング工程、ボンディング

ング工程、及びパッケージング工程（チップ封入）等の工程が必要に応じて含まれる。

【0279】

最後に、ステップ206（検査ステップ）において、ステップ205で作製されたデバイスの動作確認テスト、耐久性テスト等の検査を行う。こうした工程を経た後にデバイスが完成し、これが出荷される。

【0280】

図8には、半導体デバイスの場合における、上記ステップ204の詳細なフロー例が示されている。図8において、ステップ211（酸化ステップ）においてはウエハの表面を酸化させる。ステップ212（CVDステップ）においてはウエハ表面に絶縁膜を形成する。ステップ213（電極形成ステップ）においてはウエハ上に電極を蒸着によって形成する。ステップ214（イオン打込みステップ）においてはウエハにイオンを打ち込む。以上のステップ211～ステップ214それぞれは、ウエハ処理の各段階の前処理工程を構成しており、各段階において必要な処理に応じて選択されて実行される。

【0281】

ウエハプロセスの各段階において、上述の前処理工程が終了すると、以下のようにして後処理工程が実行される。この後処理工程では、まず、ステップ215（レジスト形成ステップ）において、ウエハに感光剤を塗布する。引き続き、ステップ216（露光ステップ）において、上で説明した露光装置10を用いてマスクの回路パターンをウエハに転写する。次に、ステップ217（現像ステップ）においては露光されたウエハを現像し、ステップ218（エッチングステップ）において、レジストが残存している部分以外の部分の露出部材をエッチングにより取り去る。そして、ステップ219（レジスト除去ステップ）において、エッチングが済んで不要となったレジストを取り除く。

【0282】

これらの前処理工程と後処理工程とを繰り返し行うことによって、ウエハ上に多重に回路パターンが形成される。

【0283】

以上説明した本実施形態のデバイス製造方法によると、露光工程（ステップ216）において上記実施形態の露光装置10を用いて露光が行われるので、露光精度の向上により、高集積度のデバイスを歩留まり良く生産することができる。

【0284】

【発明の効果】

以上説明したように、請求項1～27に記載の各発明によれば、制御に必要な要請に応じた光量制御を行うことができる光源装置を提供するができる。

【0285】

また、請求項28～33に記載の各発明によれば、要求される露光量制御を容易に実現することができる露光装置を提供することができる。

【0286】

また、請求項34～36に記載の各発明によれば、要求される露光量制御を容易に実現することができる露光方法を提供することができる。

【0287】

また、請求項37及び38に記載の各発明によれば、高集積度のマイクロデバイスの生産性を向上することができるデバイス製造方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の一実施形態に係る露光装置の構成を概略的に示す図である。

【図2】

図1の光源装置の内部構成を主制御装置とともに示すブロック図である。

【図3】

図2の光増幅部の構成を概略的に示す図である。

【図4】

光増幅部を構成する最終段のファイバ増幅器の出力端部が束ねられて形成されたバンドルーファイバの断面を示す図である。

【図5】

図2の光増幅部を構成するファイバ増幅器及びその周辺部を、波長変換部の一

部とともに概略的に示す図である。

【図6】

図6(A)は、バンドルーファイバ173の出力端から射出される波長1.544 μmの基本波を、非線形光学結晶を用いて8倍波(高調波)に波長変換して193 nmの紫外光を発生する波長変換部の構成例を示す図、図6(B)は、バンドルーファイバ173の出力端から射出される波長1.557 μmの基本波を非線形光学結晶を用いて10倍波に波長変換して157 nmの紫外光を発生する波長変換部の構成例を示す図である。

【図7】

本発明の係るデバイス製造方法の実施形態を説明するためのフローチャートである。

【図8】

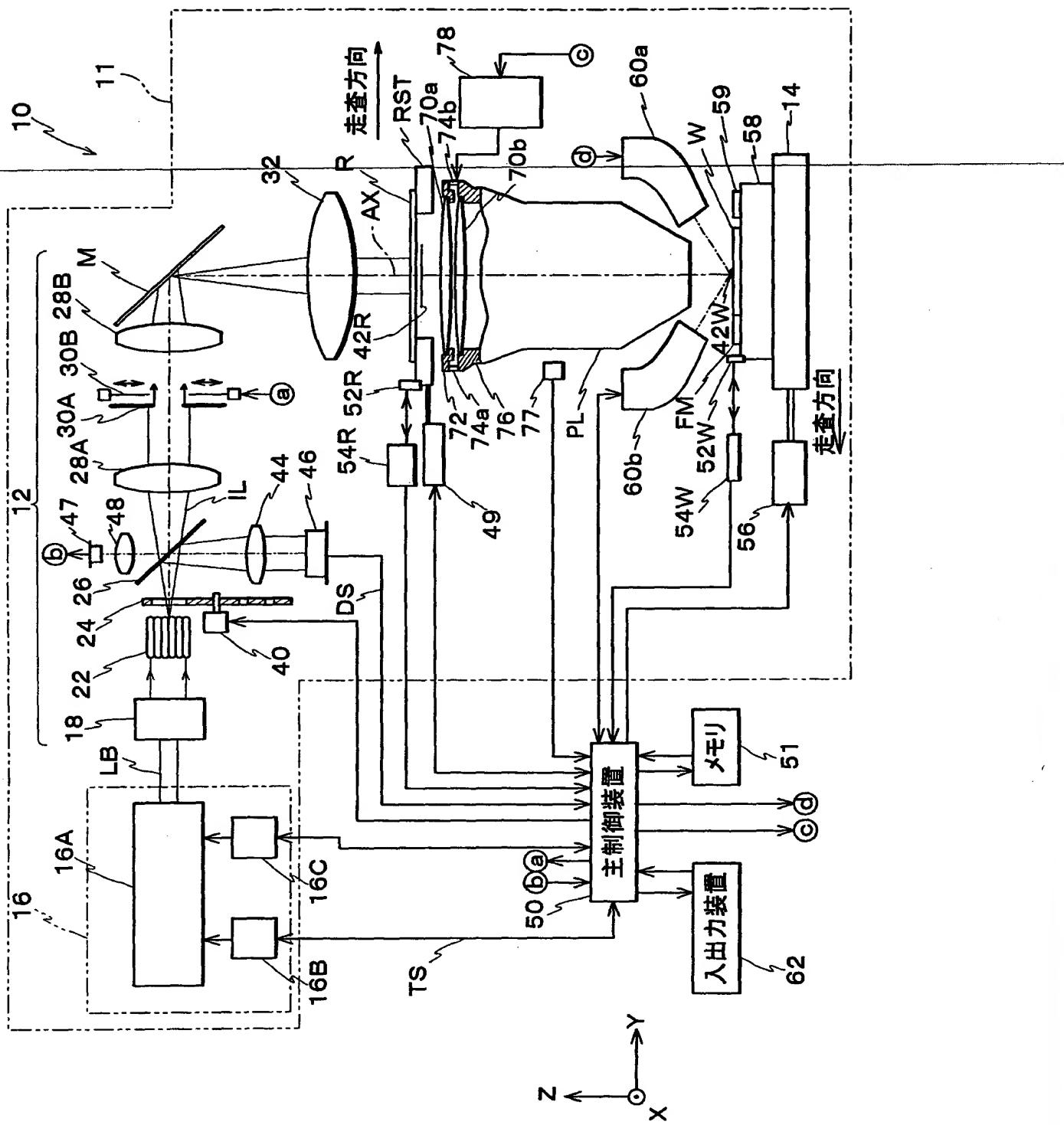
図7のステップ204における処理のを示すフローチャートである。

【符号の説明】

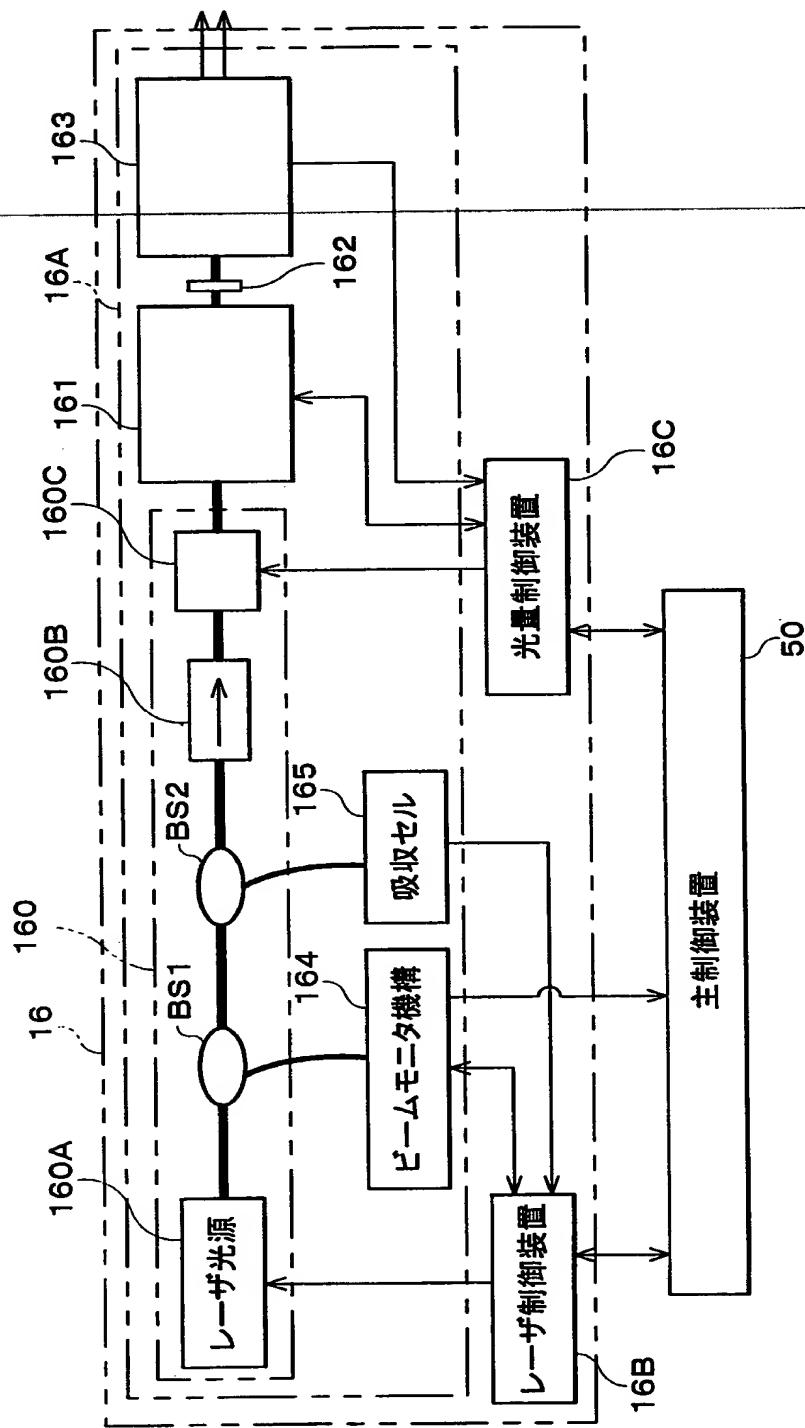
10…露光装置、12…照明光学系、16…光源装置、16C…光量制御装置
 、22…フライアイレンズ系(オプティカルインテグレータ)、50…主制御装置(制御装置)、51…メモリ(記憶装置)、160…光発生部、160A…DFB半導体レーザ(光源)、160C…EOM(光変調器)、161…光増幅部
 、163…波長変換部、167…遅延部、168_n…ファイバ増幅器、171_n…
 ファイバ増幅器、172_n…光経路、173…バンドルーファイバ(ファイバ群)
 、174…半導体レーザ(励起用光源)、178…半導体レーザ(励起用光源)
 、R…レチクル(マスク)、W…ウエハ(基板)。

【書類名】 図面

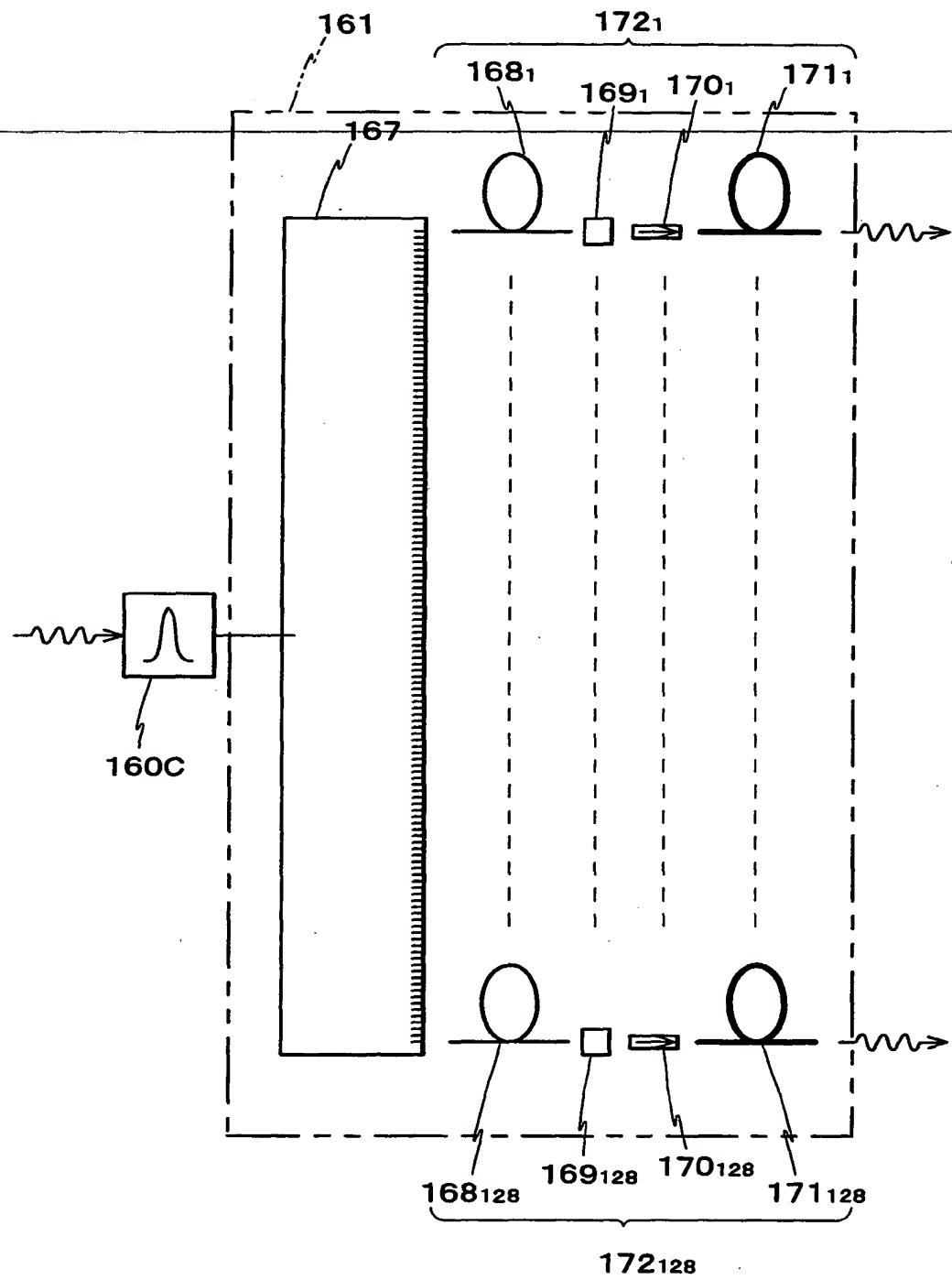
【図1】



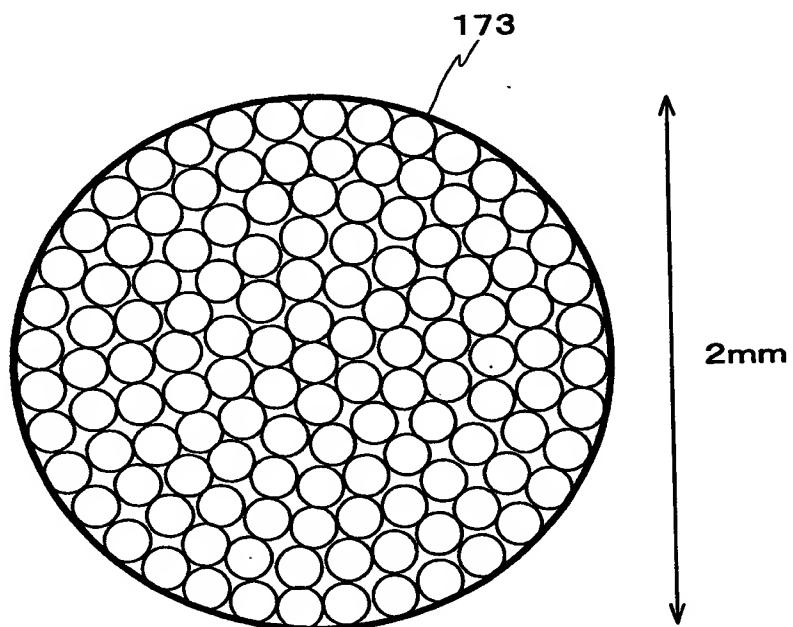
【図2】



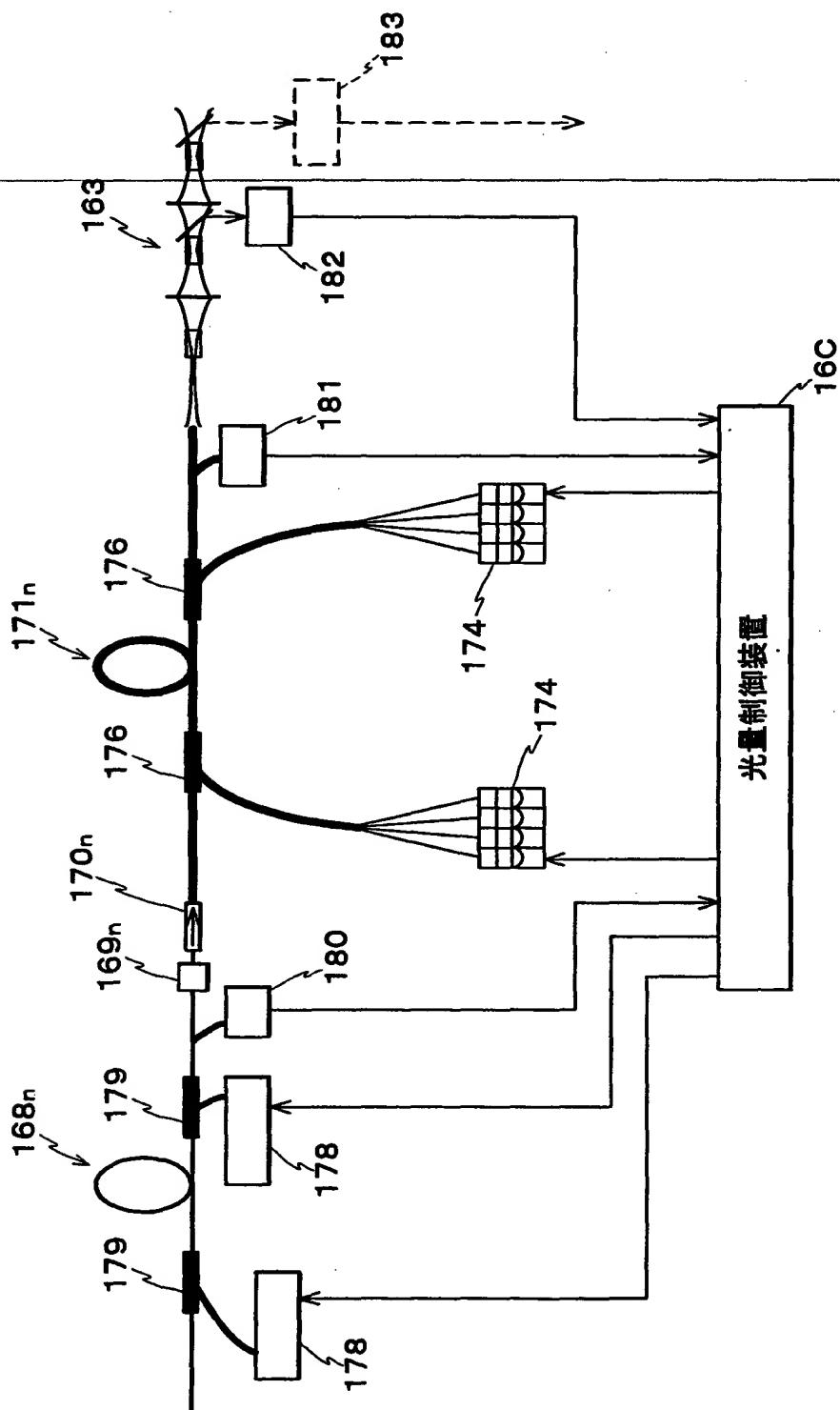
【図3】



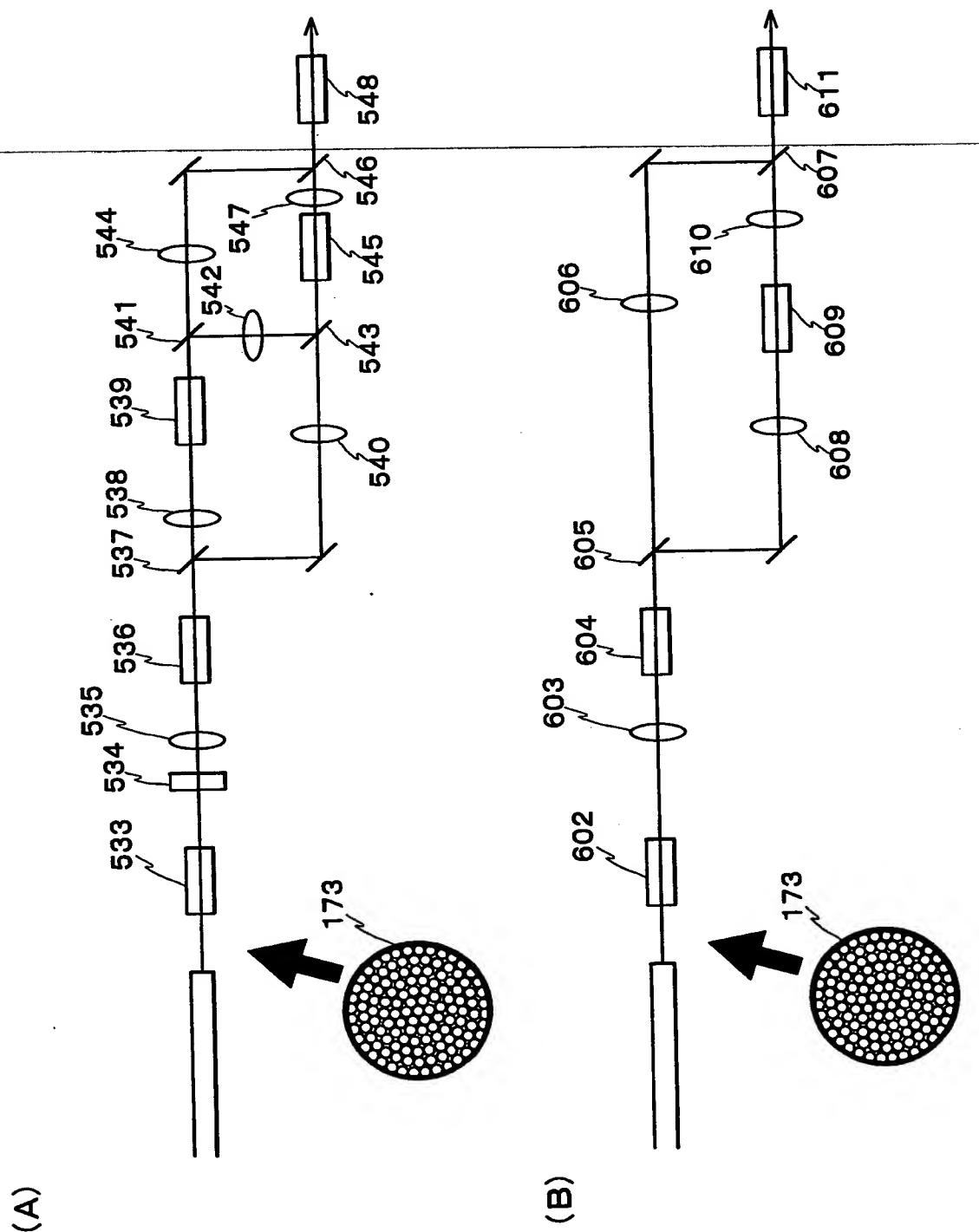
【図4】



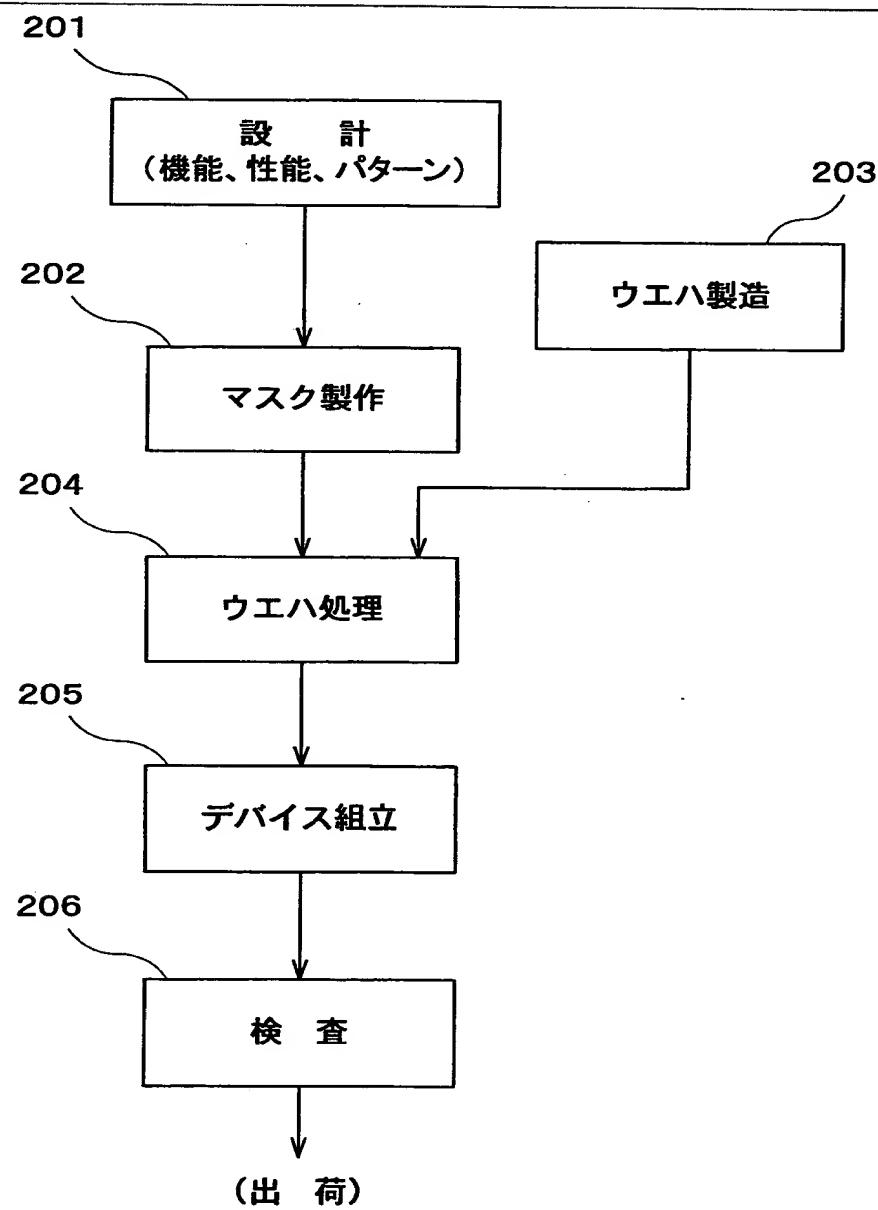
【図5】



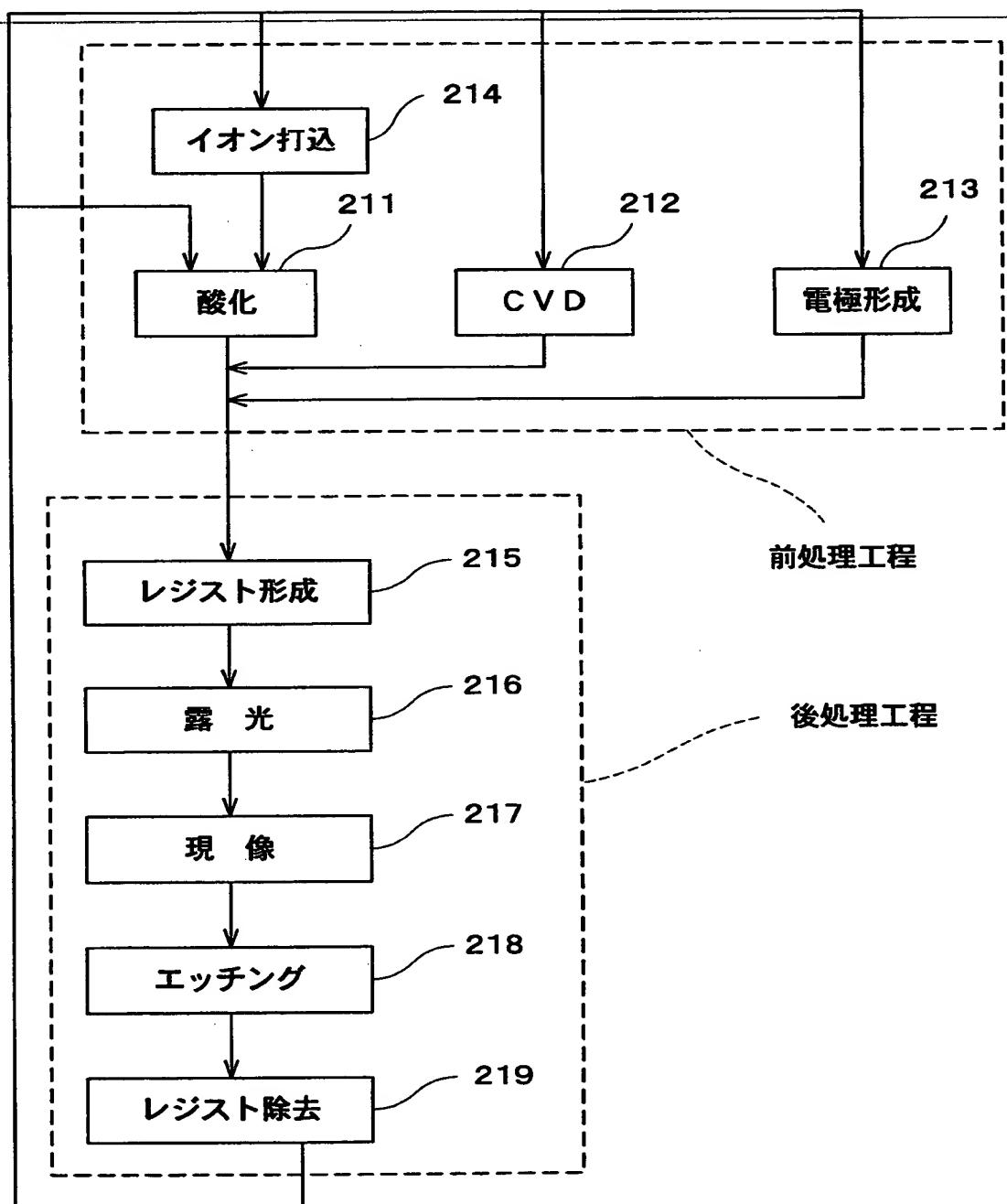
【図6】



【図7】



【図8】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 制御に必要な要請に応じた光量制御を行うことができる光源装置を提供する。

【解決手段】 光源装置16は、单一波長発生光源160Aと該光源からの光をパルス光に変換して出力する光変調器160Cとを有する光発生部160と、光変調器からのパルス光を増幅するファイバアンプを各々有する光ファイバ群から成る光増幅部161と、光量制御装置16Cとを備えている。光量制御装置160Cは、光ファイバ群を構成する各ファイバの光出力の個別オン・オフによる段階的な光量制御と、光変調器の出力パルス光の周波数及びピークパワーの少なくとも一方を制御する光量制御とを行う。従って、段階的な光量制御に加えて、各段階間の光量の微調整が前記パルス光の周波数及びピークパワーの少なくとも一方の制御により可能になり、所定範囲内であれば如何なる設定光量にも光量を一致させることができる。

【選択図】 図2

認定・付加情報

特許出願の番号	平成11年 特許願 第257969号
受付番号	59900886471
書類名	特許願
担当官	第五担当上席 0094
作成日	平成11年 9月14日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成11年 9月10日

次頁無

出願人履歴情報

識別番号 [000004112]

1. 変更年月日 1990年 8月29日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

氏 名 株式会社ニコン

